2026 年 11 月 01 日

电子行业研究

买入（维持评级）

行业深度研究

证券研究报告

电子组
分析师：樊志远（执业 S1130518070003） 分析师：丁彦文（执业 S1130524070002）
fanzhiyuan@gjzq.com.cn dingyanwen@gjzq.com.cn

AI 覆铜板/PCB 三季度业绩亮眼，Q4 有望持续

投资逻辑：

电子行业前三季度业绩保持较快增长，Q3 盈利弹性进一步释放。电子行业 2026 年前三季度实现营收 42700.89 亿元，同增 37.25%，归母净利润 4116.72 亿元，同增 88.00%。其中，2026Q3 实现营收 18203.67 亿元，同比约+46.7%，环比+33.56%；归母净利润 2379.10 亿元，同比约+80.5%，环比+111.86%。前三季度 AI 云端算力基础设施需求持续增长，国内半导体自主可控加速推进，叠加端侧 AI 与消费电子新品周期带来的需求改善，推动板块收入及盈利保持较快增长。2026 年前三季度电子行业毛利率为 21.9%，净利率为 11.2%；26Q3 毛利率为 22.6%，净利率为 11.8%。

AI 算力需求持续高景气，AI 覆铜板/PCB 三季度业绩亮眼。PCB 行业 2026 年前三季度实现营收 3324.60 亿元，同增 45.09%，归母净利润 458.32 亿元，同增 108.42%。2026Q3 实现营收 1463.39 亿元，同增 85.40%，环增 41.27%；归母净利润 240.94 亿元，同增 196.00%，环增 75.56%。受 AI 服务器、交换机及高速互联需求持续增长驱动，高多层板、高阶 HDI 及低损耗材料需求快速放量，单机柜 PCB 用量与价值量持续提升，头部厂商高端产能维持较高稼动率。

存储：周期持续上行，收入及盈利大幅改善。存储行业 2026 年前三季度实现营收 4901.52 亿元，同增 393.40%，归母净利润 1835.18 亿元，较上年同期亏损 14.89 亿元实现大幅扭亏。其中，2026Q3 实现营收 2081.63 亿元，同增 398.25%，环增 17.27%；归母净利润 696.58 亿元，同比实现大幅扭亏。AI 算力集群扩张持续拉动 HBM、企业级 SSD 等高端存储需求，存储原厂持续将产能向 HBM 等高附加值产品倾斜，传统 DRAM 与 NAND 供给保持偏紧，存储价格维持较高水平。

半导体设备：国产替代持续推进，盈利保持较快增长。半导体设备行业 2026 年前三季度实现营收 880.63 亿元，同增 24.62%，归母净利润 191.31 亿元，同增 63.57%。2026Q3 实现营收 326.90 亿元，同比约+21.8%，环比+9.42%；归母净利润 74.67 亿元，同比约+52.0%，环比+3.44%。国内晶圆厂资本开支维持较高强度，先进逻辑及存储产线扩产持续推进，叠加工艺升级带来的设备价值量提升，国产设备厂商持续受益于产能扩张及国产化率提升。

半导体设计：AI 算力与存储周期共振，盈利弹性持续释放。半导体设计板块 2026 年前三季度实现营收 1294.43 亿元，同增 41.58%，归母净利润 317.14 亿元，同增 129.73%。其中，2026Q3 实现营收 497.20 亿元，同增 49.35%，环增 10.02%；归母净利润 124.92 亿元，同增 140.73%。AI 算力需求增长推动高性能计算芯片及配套芯片持续放量，存储价格上行带动相关设计公司盈利改善；端侧 AI 硬件升级，持续拉动高性能 SoC、大容量存储、CIS 等芯片需求。

消费电子：端侧 AI 持续渗透，新品周期支撑需求。消费电子行业 2026 年前三季度实现营收 19749.35 亿元，同增 33.98%，归母净利润 823.53 亿元，同增 36.77%。其中，2026Q3 实现营收 7904.32 亿元，同增 33.06%，归母净利润 325.73 亿元，同增 18.19%。端侧 AI 持续推动智能手机、AIPC 及可穿戴设备软硬件升级；部分消费电子龙头加速向 AI 服务器、液冷散热、高速连接及精密结构件等新兴领域拓展，原有精密制造及供应链能力逐步向算力硬件环节复用。

投资建议与估值

建议关注 AI 算力硬件、半导体自主可控及端侧 AI 创新三条主线。AI 算力方面，随着新一代 GPU 及北美云厂商 ASIC 持续放量，AI 服务器、高速交换机等需求有望保持较快增长，建议关注 AI-PCB、覆铜板及上游配套产业链；半导体方面，国内先进逻辑及存储产线持续扩产，设备、零部件及材料国产替代持续推进，同时存储周期上行及国产 AI 算力芯片放量带动设计板块盈利改善，建议关注自主可控产业链核心公司；端侧 AI 方面，关注苹果新品周期、AI 智能眼镜、AIPC 及其他 AIoT 硬件创新带来的新增需求。

风险提示

终端需求不及预期的风险；AI 技术迭代及商业化进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险；上游原材料价格上涨及成本传导不及预期的风险。

内容目录

一、电子板块：2026Q1-Q3 营收同增 37.25%，归母净利润同增 88.00% 7
二、子板块：AI 算力硬件及半导体设计业绩表现亮眼 7
2.1：半导体：上游自主化加速，存储需求高增，设备与设计表现较好 8
2.2：消费电子：2026Q1-Q3 营收同增 33.98%，归母净利同增 36.77% 14
2.3：电子化学品：2026Q1-Q3 营收同增 25.34%，2026Q1-Q3 归母净利同增 30.40% 15
2.4：元件：PCB 2026Q1-Q3 营收同增,4526Q1-Q3 归母净利同增 108.42% 16
2.5：汽车电子：2026Q1-Q3 营收同增 19.65%，26Q1-Q3 归母净利同比-7.15% 18
2.6：光学光电子：2026Q1-Q3 营收同比-0.88%，26Q1-Q3 归母净利同比-27.56% 19
2.7：其他电子：2026Q1-Q3 营收同增 132.08%，26Q1-Q3 归母净利同增 152.38% 20
三、龙头表现：AI 硬件产业链公司业绩亮眼 22
3.1：消费电子 22
3.2：PCB 24
3.3：被动元件 28
3.4：汽车电子 30
3.5：半导体设计 31
3.6：功率半导体 33
3.7：半导体设备 33
3.8：晶圆代工 36
四、投资建议 36
五、风险提示 37

图表目录

图表 1： 电子行业历史营收情况 7
图表 2： 电子行业历史归母业绩情况 7
图表 3： 电子行业历史盈利能力情况 7
图表 4： 电子行业单季度历史盈利能力情况 7
图表 5： 各子板块所包含个股 8
图表 6： 半导体行业历史营收情况 8
图表 7： 半导体行业历史归母业绩情况 8
图表 8： 半导体行业历史盈利能力情况 9
图表 9： 半导体行业单季度历史盈利能力情况 9
图表 10： 半导体设备行业历史营收情况 9
图表 11： 半导体设备行业历史归母业绩情况 9

图表 12： 半导体设备行业历史盈利能力情况 10
图表 13： 半导体设备行业单季度历史盈利能力情况 10
图表 14： 半导体材料行业历史营收情况 10
图表 15： 半导体材料行业历史归母业绩情况 10
图表 16： 半导体材料行业历史盈利能力情况 11
图表 17： 半导体材料行业单季度历史盈利能力情况 11
图表 18： 功率半导体行业历史营收情况 11
图表 19： 功率半导体行业历史归母业绩情况 11
图表 20： 功率半导体行业历史盈利能力情况 12
图表 21： 功率半导体行业单季度历史盈利能力情况 12
图表 22： 存储行业历史营收情况 12
图表 23： 存储行业历史归母业绩情况 12
图表 24： 存储行业历史盈利能力情况 13
图表 25： 存储行业单季度历史盈利能力情况 13
图表 26： 算力芯片行业历史营收情况 13
图表 27： 算力芯片行业历史归母业绩情况 13
图表 28： 算力芯片行业历史盈利能力情况 14
图表 29： 算力芯片行业单季度历史盈利能力情况 14
图表 30： 半导体设计行业历史营收情况 14
图表 31： 半导体设计行业历史归母业绩情况 14
图表 32： 消费电子行业历史营收情况 15
图表 33： 消费电子行业历史归母业绩情况 15
图表 34： 消费电子行业历史盈利能力情况 15
图表 35： 消费电子行业单季度历史盈利能力情况 15
图表 36： 电子化学品行业历史营收情况 16
图表 37： 电子化学品行业历史归母业绩情况 16
图表 38： 电子化学品行业历史盈利能力情况 16
图表 39： 电子化学品行业单季度历史盈利能力情况 16
图表 40： 元件行业历史营收情况 17
图表 41： 元件行业历史归母业绩情况 17
图表 42： 元件行业历史盈利能力情况 17
图表 43： 元件行业单季度历史盈利能力情况 17
图表 44： PCB 行业历史营收情况 18
图表 45： PCB 行业历史归母业绩情况 18
图表 46： PCB 行业历史盈利能力情况 18

图表 47： PCB 行业单季度历史盈利能力情况 18
图表 48： 汽车电子行业历史营收情况 19
图表 49： 汽车电子行业历史归母业绩情况 19
图表 50： 汽车电子行业历史盈利能力情况 19
图表 51： 汽车电子行业单季度历史盈利能力情况 19
图表 52： 光学光电子行业历史营收情况 20
图表 53： 光学光电子行业历史归母业绩情况 20
图表 54： 光学光电子行业历史盈利能力情况 20
图表 55： 光学光电子行业单季度历史盈利能力情况 20
图表 56： 其他电子行业历史营收情况 21
图表 57： 其他电子行业历史归母业绩情况 21
图表 58： 其他电子行业历史盈利能力情况 21
图表 59： 其他电子行业单季度历史盈利能力情况 21
图表 60： 立讯精密营收情况 22
图表 61： 立讯精密归母净利润情况 22
图表 62： 鹏鼎控股营收情况 22
图表 63： 鹏鼎控股归母净利润情况 22
图表 64： 东山精密营收情况 23
图表 65： 东山精密归母净利润情况 23
图表 66： 传音控股营收情况 23
图表 67： 传音控股归母净利润情况 23
图表 68： 领益智造营收情况 24
图表 69： 领益智造归母净利润情况 24
图表 70： 蓝思科技营收情况 24
图表 71： 蓝思科技归母净利润情况 24
图表 72： 沪电股份营收情况 25
图表 73： 沪电股份归母净利润情况 25
图表 74： 深南电路营收情况 25
图表 75： 深南电路归母净利润情况 25
图表 76： 兴森科技营收情况 26
图表 77： 兴森科技归母净利润情况 26
图表 78： 胜宏科技营收情况 26
图表 79： 胜宏科技归母净利润情况 26
图表 80： 生益科技营收情况 27
图表 81： 生益科技归母净利润情况 27

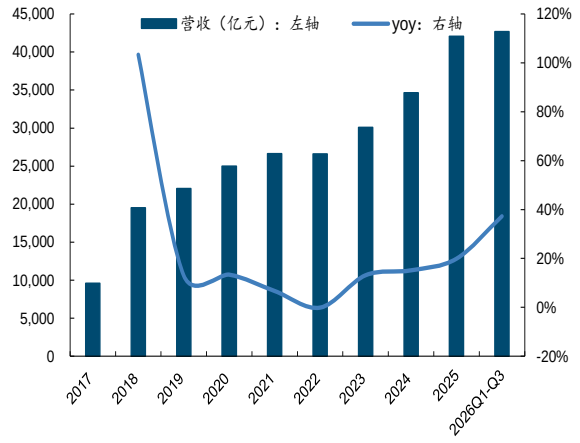
图表 82： 南亚新材营收情况 27
图表 83： 南亚新材归母净利润情况 27
图表 84： 瑞联新材营收情况 28
图表 85： 瑞联新材归母净利润情况 28
图表 86： 顺络电子营收情况 28
图表 87： 顺络电子归母净利润情况 28
图表 88： 三环集团营收情况 29
图表 89： 三环集团归母净利润情况 29
图表 90： 铂科新材营收情况 29
图表 91： 铂科新材归母净利润情况 29
图表 92： 洁美科技营收情况 30
图表 93： 洁美科技归母净利润情况 30
图表 94： 电连技术营收情况 30
图表 95： 电连技术归母净利润情况 30
图表 96： 瑞可达营收情况 31
图表 97： 瑞可达归母净利润情况 31
图表 98： 晶晨股份营收情况 31
图表 99： 晶晨股份归母净利润情况 31
图表 100： 兆易创新营收情况 32
图表 101： 兆易创新归母净利润情况 32
图表 102： 圣邦股份营收情况 32
图表 103： 圣邦股份归母净利润情况 32
图表 104： 澜起科技营收情况 33
图表 105： 澜起科技归母净利润情况 33
图表 106： 新洁能营收情况 33
图表 107： 新洁能归母净利润情况 33
图表 108： 北方华创营收情况 34
图表 109： 北方华创归母净利润情况 34
图表 110： 中微公司营收情况 34
图表 111： 中微公司归母净利润情况 34
图表 112： 精测电子营收情况 35
图表 113： 精测电子归母净利润情况 35
图表 114： 拓荆科技营收情况 35
图表 115： 拓荆科技归母净利润情况 35
图表 116： 芯源微营收情况 36

图表 117： 芯源微归母净利润情况 36
图表 118： 晶合集成营收情况 36
图表 119： 晶合集成归母净利润情况 36

一、电子板块：2026Q1-Q3 营收同增 37.25%，归母净利润同增 88.00%

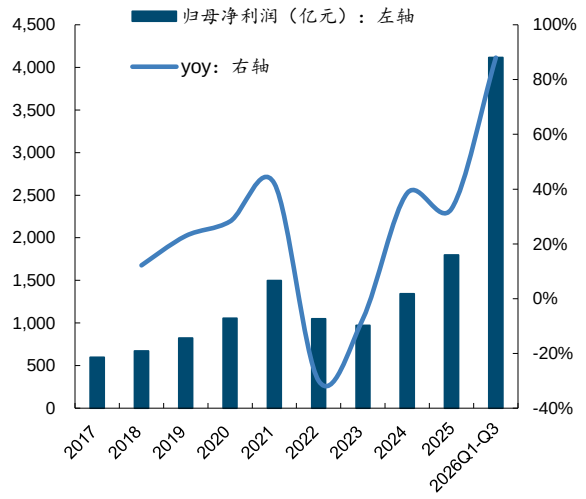
电子行业 2026 年前三季度实现营收 42700.89 亿元，同增 37.25%，归母净利润 4116.72 亿元，同增 88.00%。其中，2026Q3 实现营收 18203.67 亿元，同比约+46.7%，环比+33.56%；归母净利润 2379.10 亿元，同比约+80.5%，环比+111.86%。前三季度板块业绩延续高景气，收入增速较上半年进一步提升，主要受益于 AI 云端算力基础设施需求持续增长、国内半导体自主可控加速推进，以及端侧 AI 与消费电子新品周期带来的需求改善。从单季度看，Q3 收入及利润均实现明显环比增长，利润端弹性进一步释放。展望后续，随着新一代 AI 算力芯片及配套硬件持续放量、端侧 AI 应用加速渗透以及国产半导体产业链持续突破，建议关注 AI 算力核心硬件、苹果产业链及自主可控受益产业链。

图表1：电子行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

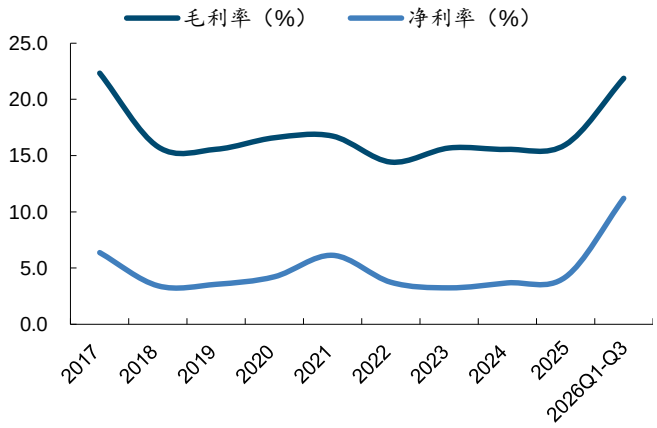
图表2：电子行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

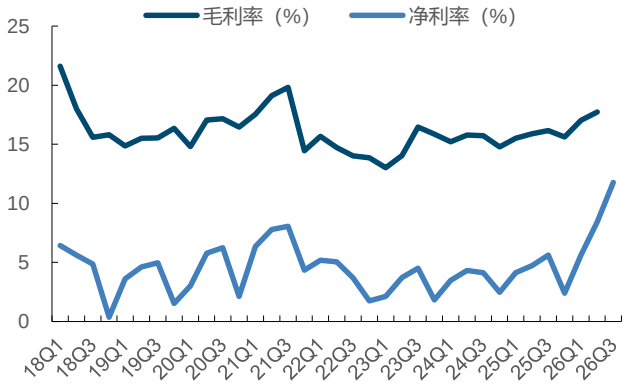
2026 年前三季度电子行业盈利能力进一步提升。电子行业 2026 年前三季度毛利率为 21.9%，净利率为 26Q3 毛利率为 22.6%，同比+6.5pct，环比+4.9pct；净利率为 11.8%，同比+6.1pct，环比+3.3pct。单季度盈利能力显著改善，主要受益于 AI 算力等高景气、高附加值业务占比持续提升，叠加产品结构优化及规模效应进一步释放，板块利润弹性持续体现。

图表3：电子行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表4：电子行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

二、子板块：AI 算力硬件及半导体设计业绩表现亮眼

我们重点跟踪半导体（半导体设备、半导体材料、功率半导体、IC 设计等细分板块）、电子元件、消费电子、光学光电子、电子化学品、其他电子、汽车电子的财务数据表现，其中电子元件、消费电子、光学光电子、电子化学品、其他电子、半导体板块所包含个股与申万二级行业分类（2021）一致，半导体设备、半导体材料所包含个股与申万三级行业分类（2021）一致，汽车电子板块包含汽车连接器、汽车光学、汽车显示 3 大子板块，各子板块所包含个股详见图表。

图表5：各子板块所包含个股

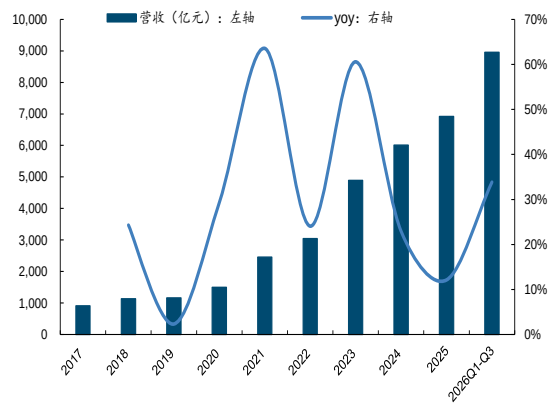
汽车连接器子板块		汽车光学子板块		汽车显示子板块		存储		功率半导体		算力芯片	
证券代码	证券简称	证券代码	证券简称	证券代码	证券简称	603986.SH	兆易创新	300373.SZ	扬杰科技	688008.SH	澜起科技
002475.SZ	立讯精密	002273.SZ	水晶光电	000050.SZ	深天马A	688008.SH	澜起科技	300623.SZ	捷捷微电	688795.SH	摩尔线程
002179.SZ	中航光电	002036.SZ	联创电子	688055.SH	龙腾光电	300475.SZ	香农芯创	600360.SH	华微电子	688802.SH	沐曦股份
002025.SZ	航天电器	688048.SH	长光华芯	300088.SZ	长信科技	301308.SZ	江波龙	600460.SH	士兰微	688041.SH	海光信息
300679.SZ	电连技术	688167.SH	炬光科技	003019.SZ	宸展光电	688525.SH	佰维存储	603290.SH	斯达半导	688256.SH	寒武纪
688800.SH	瑞可达	603297.SH	永新光学	300939.SZ	秋田微	001309.SZ	德明利	605111.SH	新洁能	688521.SH	芯原股份
605333.SH	沪光股份	300790.SZ	宇瞳光学	300928.SZ	华安鑫创	688825.SH	长鑫科技	688187.SH	时代电气		
605005.SH	合兴股份	002222.SZ	福晶科技	300752.SZ	隆利科技			688261.SH	东微半导		
002055.SZ	得润电子	688127.SH	蓝特光学	605218.SH	伟时电子			688396.SH	华润微		
688668.SH	鼎通科技	605118.SH	力鼎光电								
002897.SZ	意华股份	688079.SH	美迪凯								
300351.SZ	永贵电器	300552.SZ	万集科技								
300843.SZ	胜蓝股份	688010.SH	福光股份								
603633.SH	徕木股份	300691.SZ	联合光电								
		688195.SH	腾景科技								

来源：国金证券研究所

2.1：半导体：上游自主化加速，存储需求高增，设备与设计表现较好

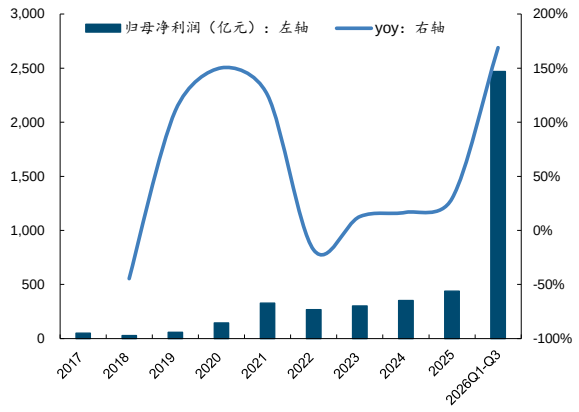
整体来看，根据申万二级行业分类，半导体行业 2026 年前三季度实现营收 8958.04 亿元，同增 33.84%，归母净利润 2470.07 亿元，同增 168.97%。其中，2026Q3 实现营收 4660.66 亿元，同比约+39.1%，环比+77.33%；归母净利润 1680.94 亿元，同比约+152.1%，环比+201.48%。前三季度国内先进逻辑及先进存储产能持续扩张，先进制程良率稳步改善，叠加先进封装能力持续提升，国产 AI 芯片供应链瓶颈进一步缓解。同时，国内晶圆厂资本开支维持较高强度，核心产线建设持续推进，带动半导体设备及零部件国产替代加速。存储周期上行及 AI 算力需求持续高景气，推动相关设计公司收入与盈利保持较快增长。从单季度看，Q3 板块收入环比明显增长，利润端弹性进一步释放。受益于存储周期上行、AI 算力放量及国产替代共振，半导体板块前三季度利润增速仍显著高于收入增速。

图表6：半导体行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

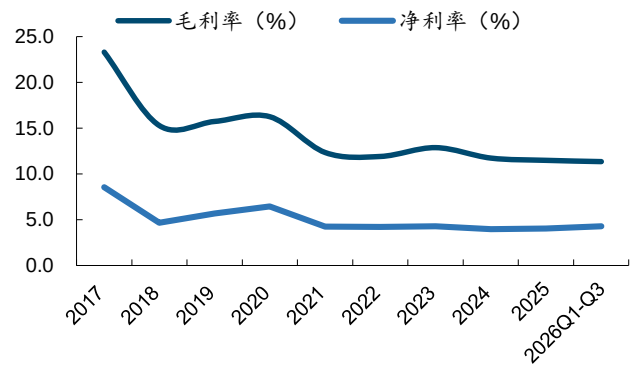
图表7：半导体行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

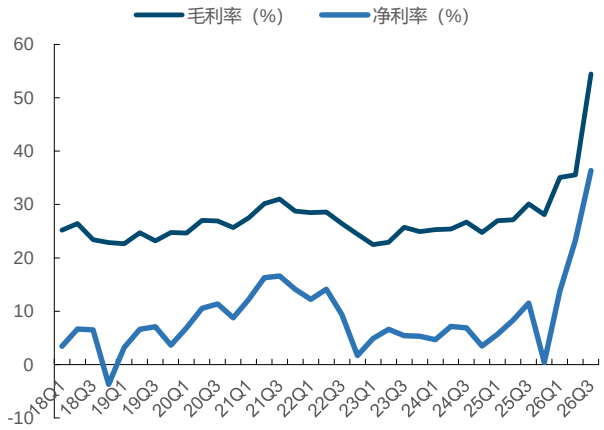
半导体行业 26Q3 盈利能力显著提升。26Q3 毛利率为 54.5%，同比+24.4pct，环比+18.9pct；净利率为 36.4%，同比+24.9pct，环比+13.1pct。

图表8：半导体行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表9：半导体行业单季度历史盈利能力情况

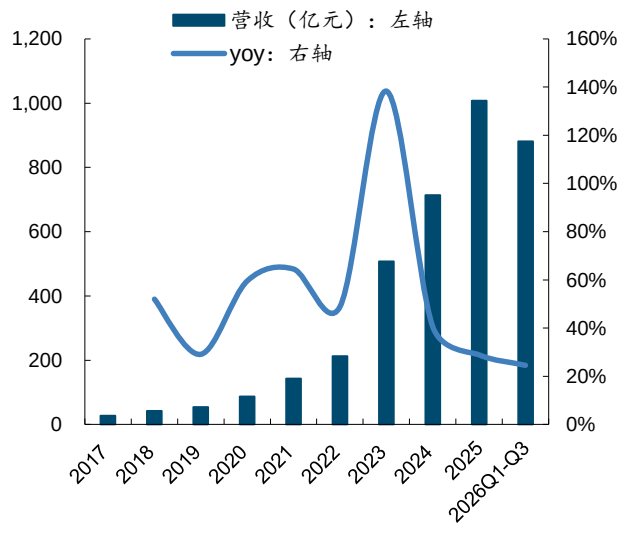


来源：wind、国金证券研究所

中美贸易摩擦与外部技术封锁常态化背景下，半导体设备及零部件国产替代持续推进。国内晶圆厂资本开支维持较高强度，先进逻辑及存储产线扩产持续落地，叠加工艺升级带来的设备价值量提升，国产设备厂商订单及收入保持较快增长。后续随着国内先进制程、先进存储持续扩产，以及关键设备国产化率进一步提升，半导体设备板块有望继续受益。

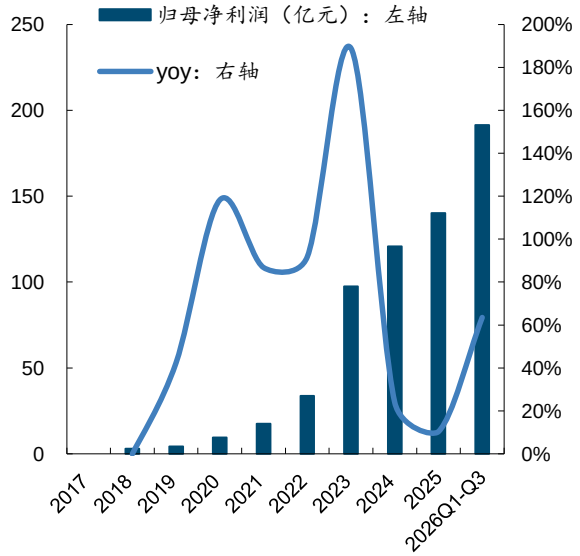
半导体设备行业 2026 年前三季度实现营收 880.63 亿元，同增 24.62%，归母净利润 191.31 亿元，同增 63.57%，利润增速显著高于收入增速。其中，2026Q3 实现营收 326.90 亿元，同比约+21.8%，环比+9.42%；归母净利润 74.67 亿元，同比约+52.0%，环比+3.44%。前三季度国内晶圆厂扩产及国产替代需求延续，设备厂商收入保持较快增长；利润端继续保持较高增速，主要受益于收入规模扩大、产品结构优化及规模效应持续释放。

图表10：半导体设备行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

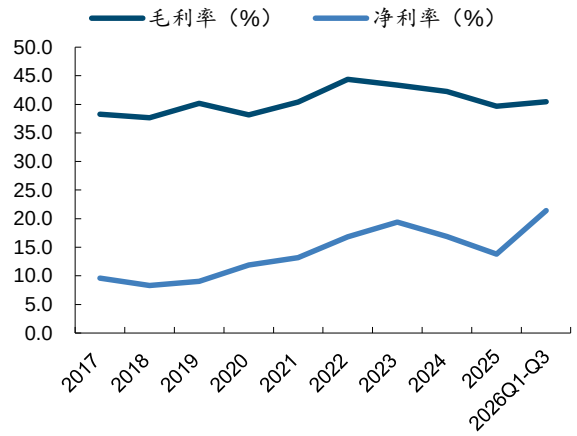
图表11：半导体设备行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

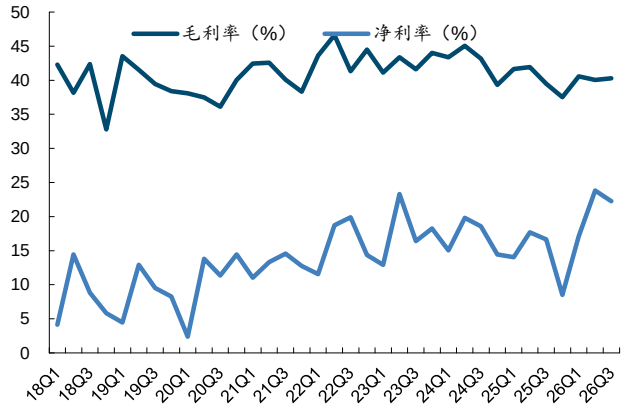
半导体设备行业 2026 年前三季度毛利率为 40.4%，净利率为 21.4%。26Q3 毛利率为 40.3%，同比+0.8pct，环比+0.2pct；净利率为 22.3%，同比+5.6pct，环比-1.5pct。

图表12：半导体设备行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

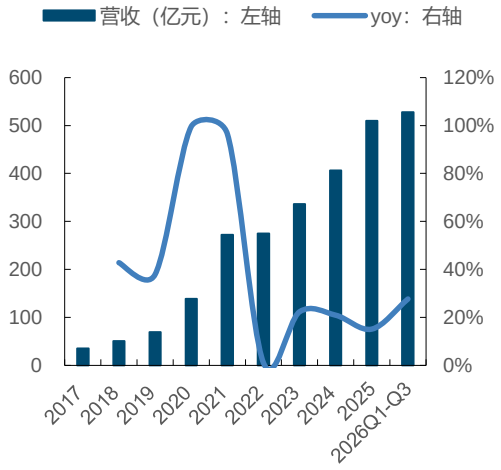
图表13：半导体设备行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

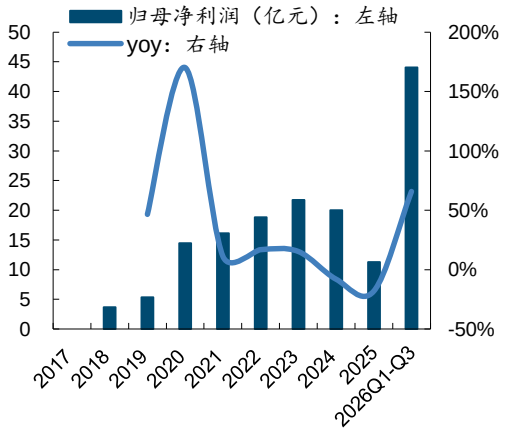
半导体材料行业 2026 年前三季度实现营收 528.10 亿元，同增 27.64%，归母净利润 44.06 亿元，同增 65.90%。其中，2026Q3 实现营收 218.09 亿元，同比+74.3%，环比+30.2%；归母净利润 30.41 亿元，同比+300.1%，环比+209.7%，单季度利润弹性显著释放。半导体材料行业具有一定后周期属性，需求释放通常滞后于晶圆厂扩产与设备进场。随着国内晶圆厂产能持续爬坡、先进逻辑及存储产线逐步放量，光刻胶、电子特气、湿电子化学品、靶材等材料需求稳步增长。

图表14：半导体材料行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

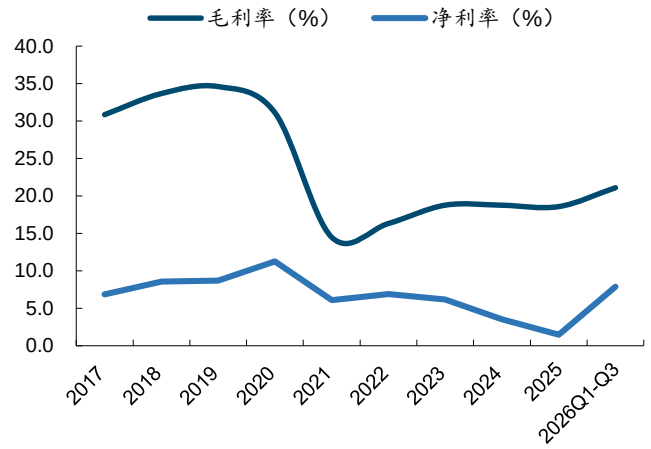
图表15：半导体材料行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

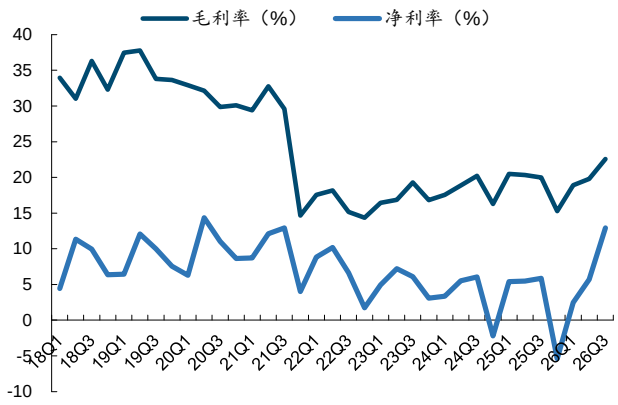
半导体材料行业 2026 年前三季度毛利率为 21.1%，净利率为 7.9%。26Q3 毛利率为 22.6%，同比+2.6pct，环比+2.8pct；净利率为 12.9%，同比+7.1pct，环比+7.2pct。

图表16：半导体材料行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

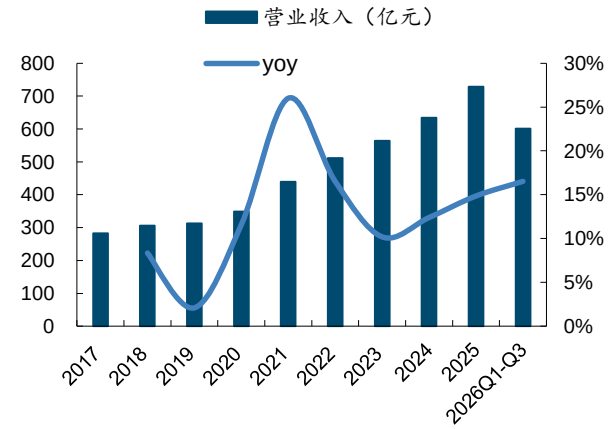
图表17：半导体材料行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

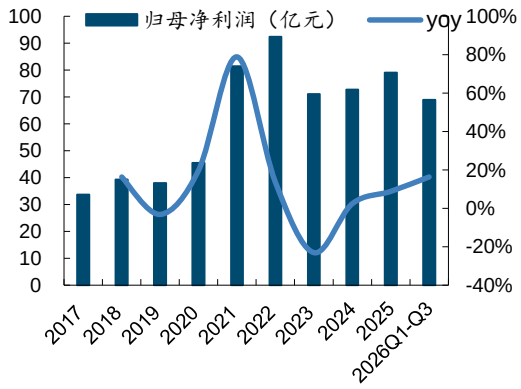
功率半导体行业 2026 年前三季度实现营收 600.65 亿元，同增 16.53%，归母净利润 68.96 亿元，同增 18.30%。其中，2026Q3 实现营收 218.17 亿元，同增 21.26%，环增 1.99%；归母净利润 23.54 亿元，同增 14.21%，环降 12.49%。在汽车电气化、智能化持续深化的背景下，800V 高压平台渗透率提升，带动 SiC MOSFET 及高性能 IGBT 模块需求持续增长；同时，AI 服务器与数据中心功率密度提升，对高效率、高功率密度电源方案提出更高要求，带动高端 MOSFET、GaN 等功率器件需求扩张。整体来看，前三季度行业收入保持稳健增长，但 26Q3 利润增速低于收入增速且环比有所回落，盈利端表现相对承压。

图表18：功率半导体行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

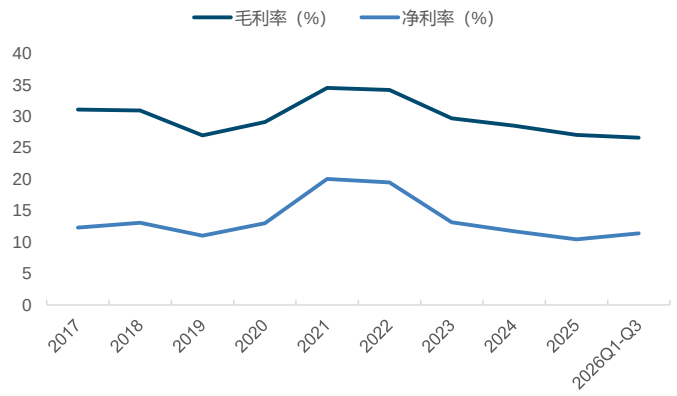
图表19：功率半导体行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

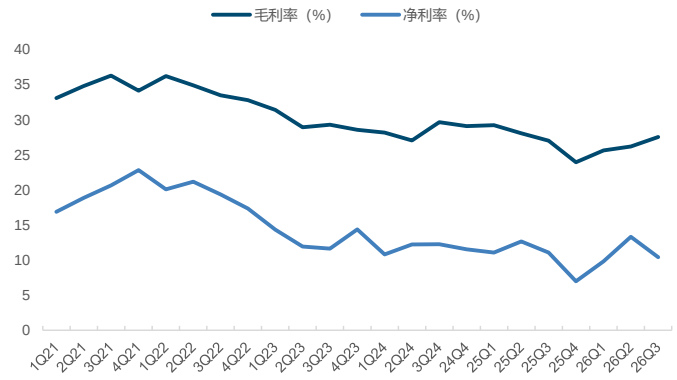
功率半导体行业 2026 年前三季度毛利率为 26.6%，净利率为 11.4%。26Q3 毛利率为 27.6%，同比+0.6pct，环比+1.4pct；净利率为 10.4%，同比-0.7pct，环比-2.9pct。

图表20：功率半导体行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

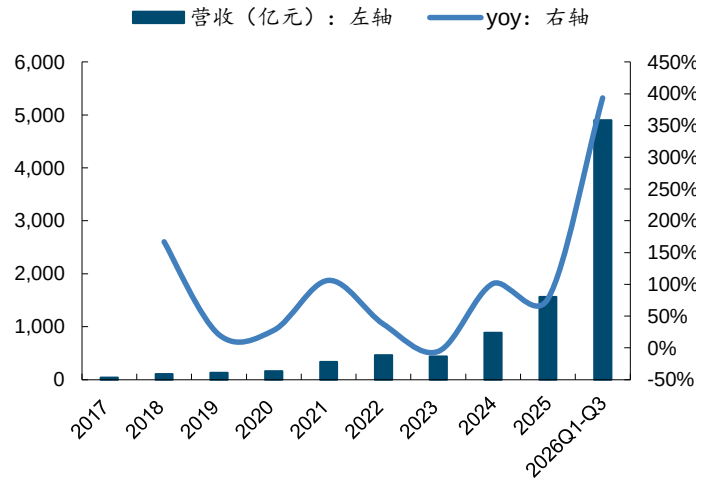
图表21：功率半导体行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

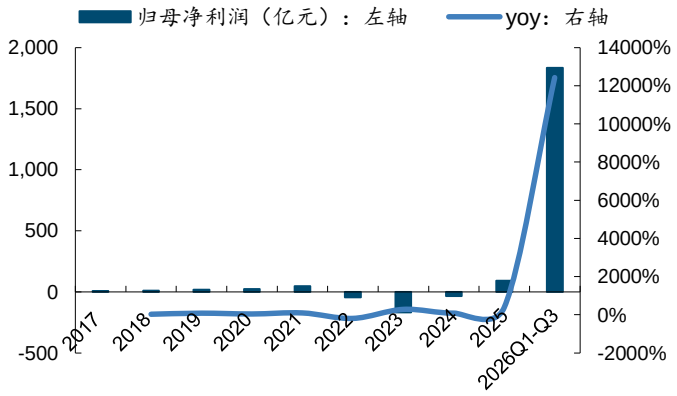
存储行业 2026 年前三季度实现营收 4901.52 亿元，同增 393.40%，归母净利润 1835.18 亿元，较上年同期亏损 14.89 亿元实现大幅扭亏。其中，2026Q3 实现营收 2081.63 亿元，同增 398.25%，环增 17.27%；归母净利润 696.58 亿元，较上年同期亏损 7.21 亿元实现扭亏，环比下降 7.56%。大模型迭代与算力集群扩张持续增加对高带宽、大容量存储的需求，带动 HBM 与企业级 SSD（eSSD）需求快速增长；同时海外原厂持续将产能向 HBM 等高附加值产品倾斜，传统 DRAM 与 NAND 供给维持偏紧，存储产品价格保持较高水平。国内存储厂商受益于行业景气上行、前期低价库存释放及产品结构优化，收入与盈利均大幅改善。单季度来看，Q3 收入继续环比增长，但归母净利润较 Q2 小幅回落；整体仍受益于存储周期上行、AI 需求高景气及国产替代推进。

图表22：存储行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

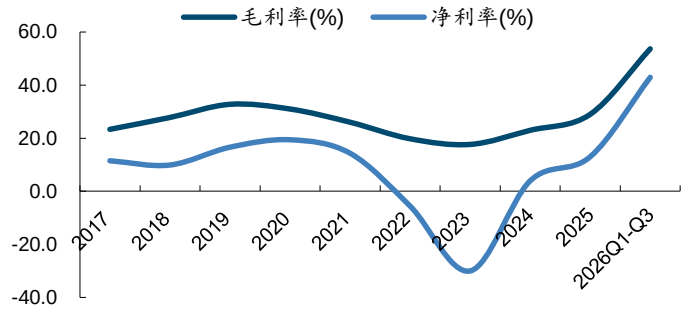
图表23：存储行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

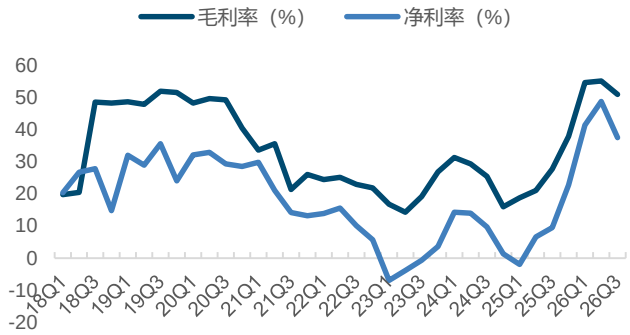
存储行业 2026 年前三季度毛利率为 53.6%，净利率为 43.0%。26Q3 毛利率为 50.8%，同比+23.1pct，环比-4.2pct；净利率为 37.4%，同比+28.0pct，环比-11.3pct。

图表24：存储行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

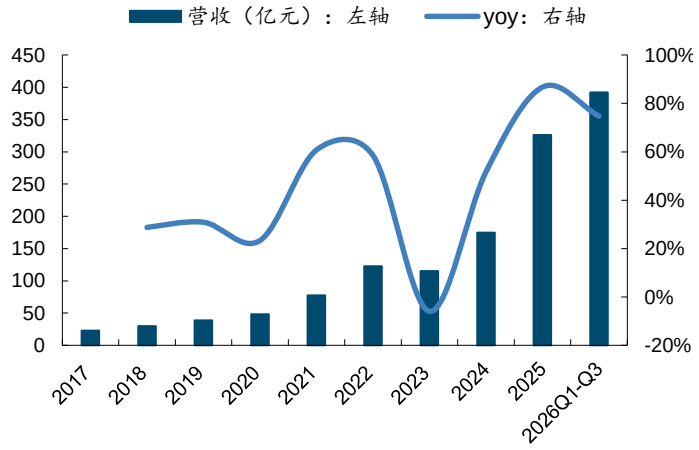
图表25：存储行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

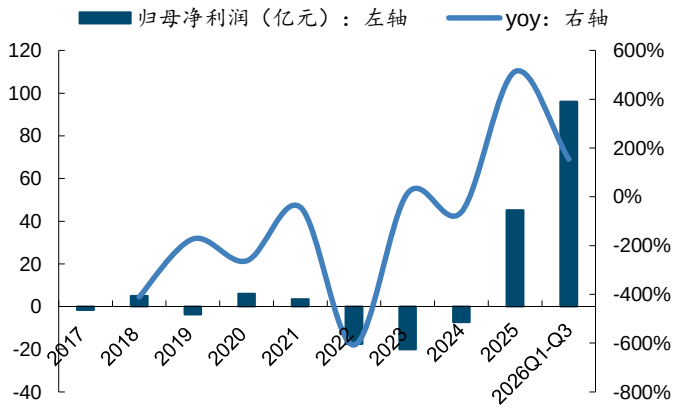
算力芯片行业 2026 年前三季度实现营收 391.89 亿元，同增 74.71%，归母净利润 96.06 亿元，同增 153.94%，利润增速显著高于收入增速。其中，2026Q3 实现营收 158.35 亿元，同增 78.70%，环增 23.33%；归母净利润 35.10 亿元，同增 202.40%，环降 11.32%。随着国内大模型持续迭代，算力需求由训练向推理侧加速延伸，叠加互联网、运营商及政企客户对国产算力基础设施投入增加，带动国产 GPU、ASIC 等算力芯片出货规模持续提升。在供应链安全与自主可控驱动下，国产算力芯片的产品验证、生态适配及客户导入不断推进，头部厂商逐步进入规模化放量阶段。前三季度板块收入与利润均保持高速增长，规模效应及高端算力芯片占比提升持续支撑盈利表现；单季度来看，Q3 收入继续环比增长，归母净利润同比大幅增长，但较 Q2 高位有所回落。

图表26：算力芯片行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

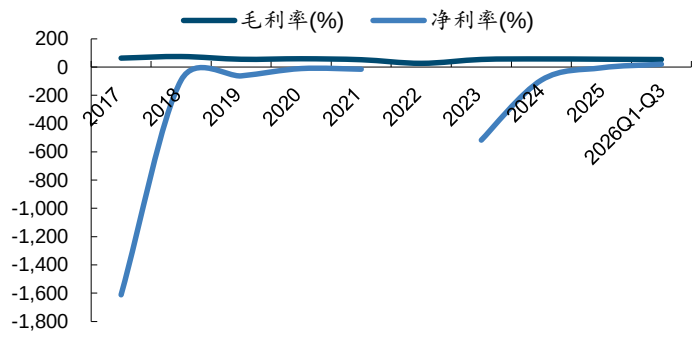
图表27：算力芯片行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

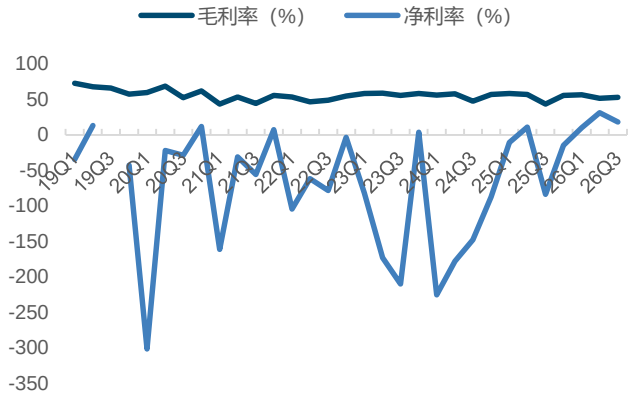
算力芯片行业 2026 年前三季度毛利率为 53.0%，同比-1.9pct，净利率为 19.5%，同比+24.8pct。26Q3 毛利率为 52.8%，同比+9.2pct，环比+1.5pct；净利率为 18.0%，同比+101.81pct，环比-13.2pct。

图表28：算力芯片行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

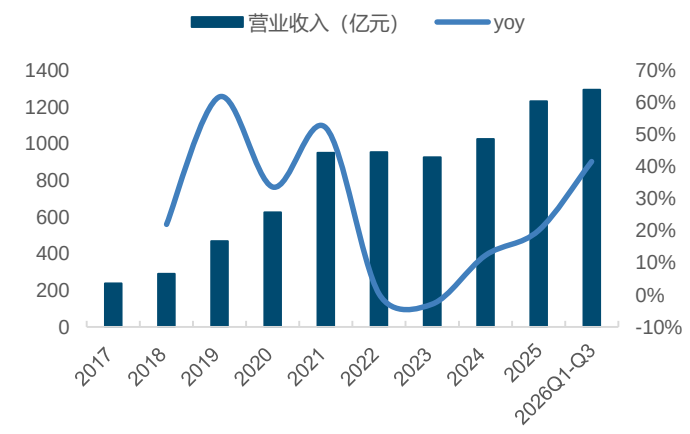
图表29：算力芯片行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

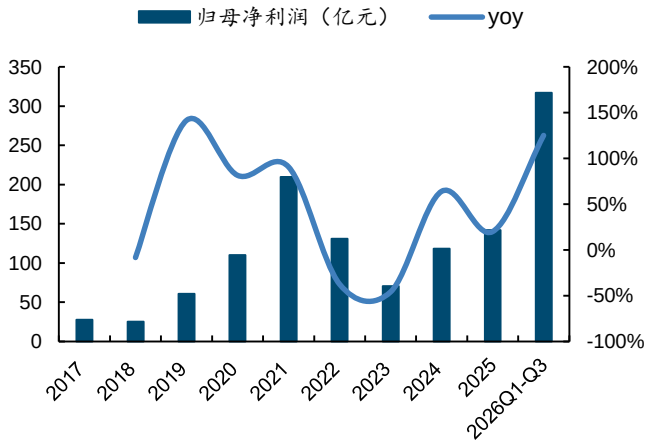
半导体设计板块 2026 年前三季度实现营收 1294.43 亿元，同比增长 41.58%，实现归母净利润 317.14 亿元，同比增长 129.73%，利润增速显著高于收入增速。其中，2026Q3 实现营收 497.20 亿元，同增 49.35%，环增 10.02%；归母净利润 124.92 亿元，同增 140.73%，环降 5.93%。人工智能与云计算基础设施持续扩张，叠加端侧 AI 加速渗透，推动半导体设计行业需求保持高景气。存储价格上行带来的盈利弹性持续释放，AI 算力需求增长推动高性能计算芯片及配套芯片加速放量；同时，AI 手机、AIPC 及智能眼镜等端侧 AI 硬件持续升级，带动高性能 SoC、大容量存储、高阶 CIS 及电源管理芯片需求增长。

图表30：半导体设计行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

图表31：半导体设计行业历史归母业绩情况

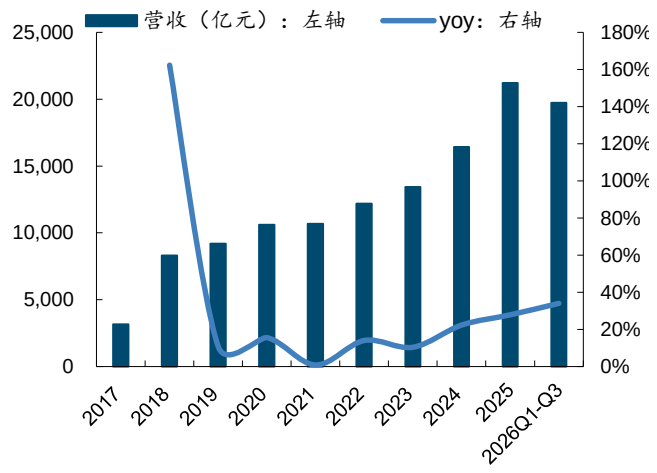


来源：wind、国金证券研究所

2.2：消费电子：2026Q1-Q3 营收同增 33.98%，归母净利同增 36.77%

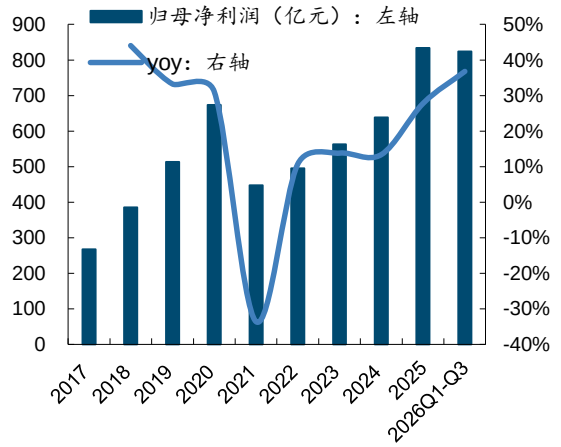
消费电子行业 2026 年前三季度实现营收 19749.35 亿元，同增 33.98%，归母净利润 823.53 亿元，同增 36.77%。其中，2026Q3 实现营收 7904.32 亿元，同增 33.06%，环增 22.88%；归母净利润 325.73 亿元，同增 18.19%，环增 13.19%。前三季度端侧 AI 持续推动智能手机、AIPC 及可穿戴设备软硬件升级，叠加新品周期带动换机需求改善，消费电子产业链景气度延续。同时，部分消费电子龙头加速向 AI 服务器、液冷散热、高速连接及精密结构件等新兴领域拓展，原有精密制造与供应链管理能力逐步向算力硬件环节复用。

图表32：消费电子行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

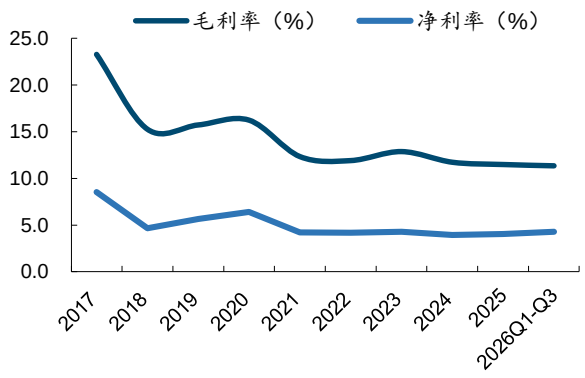
图表33：消费电子行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

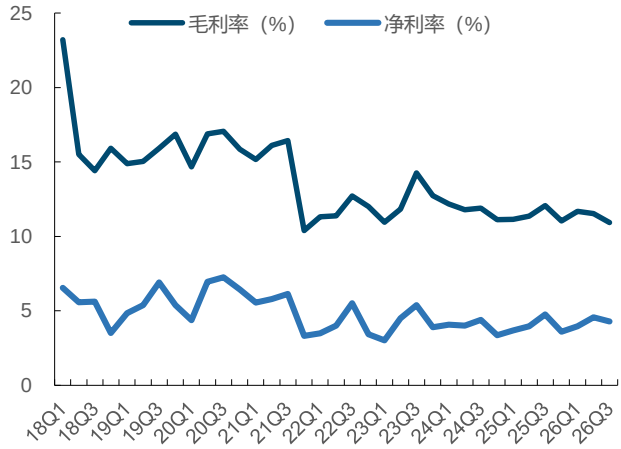
消费电子行业 2026 年前三季度毛利率为 11.3%，净利率为 4.3%。26Q3 毛利率为 10.9%，同比-1.1pct，环比-0.6pct；净利率为 4.3%，同比-0.5pct，环比-0.3pct。

图表34：消费电子行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表35：消费电子行业单季度历史盈利能力情况

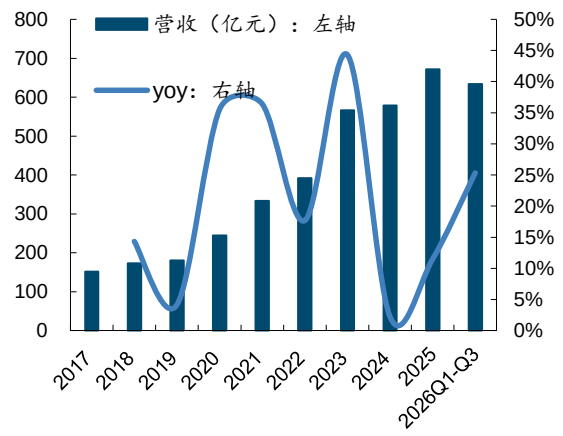


来源：wind、国金证券研究所

2.3：电子化学品：2026Q1-Q3 营收同增 25.34%，2026Q1-Q3 归母净利同增 30.40%

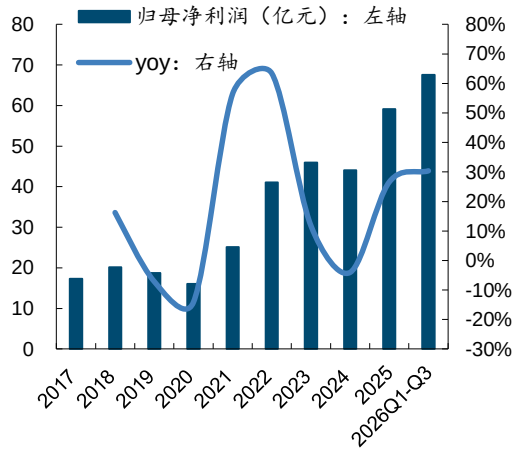
电子化学品行业 2026 年前三季度实现营收 633.82 亿元，同增 25.34%，归母净利润 67.60 亿元，同增 30.40%。其中，2026Q3 实现营收 245.57 亿元，同增 34.37%，环增 17.09%；归母净利润 30.62 亿元，同增 58.71%，环增 50.76%。随着国内晶圆厂扩产及产能利用率提升，湿电子化学品、电子特气、光刻胶及配套材料需求持续增长，叠加国产替代推进，板块收入保持较快增长。单季度来看，Q3 收入及利润均实现较快增长，利润增速明显高于收入增速，盈利弹性有所增强。

图表36：电子化学品行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

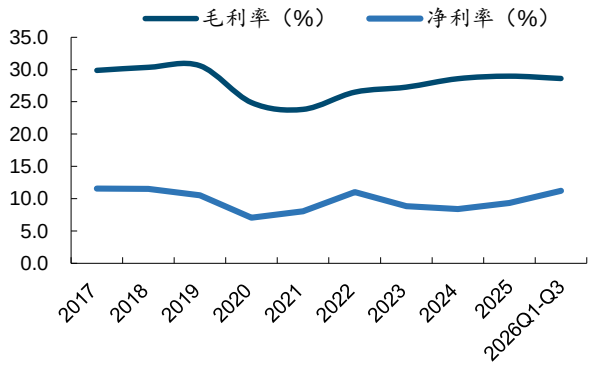
图表37：电子化学品行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

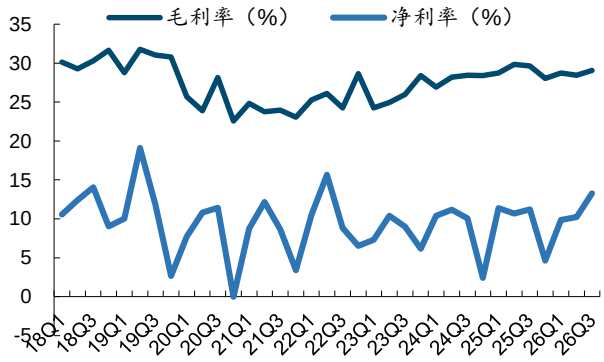
盈利能力保持稳定。电子化学品行业 2026 年前三季度毛利率为 28.6%，净利率为 11.2%。26Q3 毛利率为 29.1%，同比-0.6pct，环比+0.6pct；净利率为 13.3%，同比+2.1pct，环比+3.0pct。

图表38：电子化学品行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表39：电子化学品行业单季度历史盈利能力情况

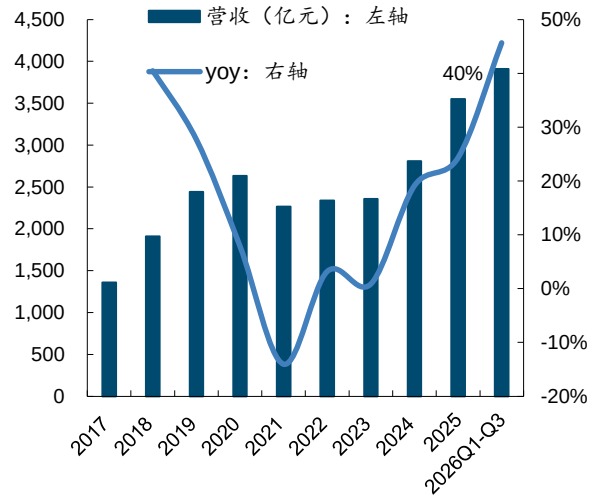


来源：wind、国金证券研究所

2.4：元件：PCB 2026Q1-Q3 营收同增 45.09%，26Q1-Q3 归母净利同增 108.42%

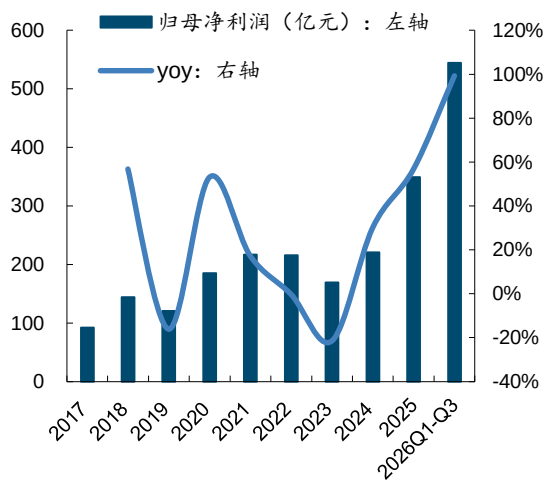
元件行业 2026 年前三季度实现营收 3909.58 亿元，同增 45.69%，归母净利润 544.64 亿元，同增 99.24%。其中，2026Q3 实现营收 1695.15 亿元，同增 82.53%，环增 37.25%；归母净利润 280.55 亿元，同增 179.15%，环增 70.96%。前三季度 AI 服务器、高速互联及高端算力硬件需求保持高景气，持续带动 PCB、连接器、被动元件等细分环节需求增长；同时汽车电子及消费电子需求改善，也对板块形成一定支撑。单季度来看，Q3 收入及利润均明显提速，利润增速显著高于收入增速，板块盈利弹性进一步释放。

图表40：元件行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

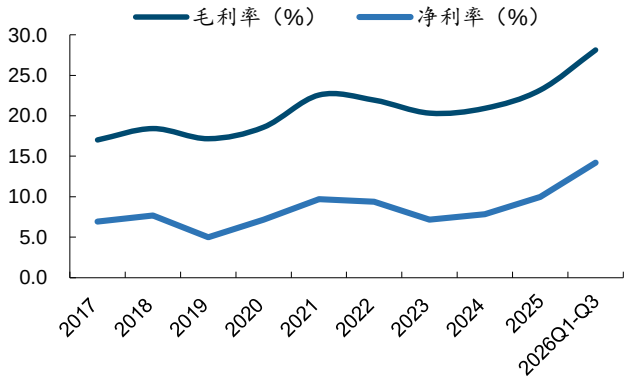
图表41：元件行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

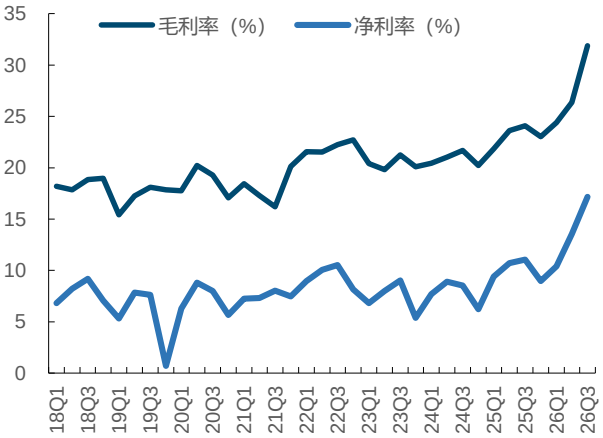
盈利能力持续改善。元件行业 2026 年前三季度毛利率为 28.1%，净利率为 14.2%。26Q3 毛利率为 31.9%，同比+7.8pct，环比+5.5pct；净利率为 17.2%，同比+6.1pct，环比+3.6pct，单季度盈利能力进一步提升。

图表42：元件行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

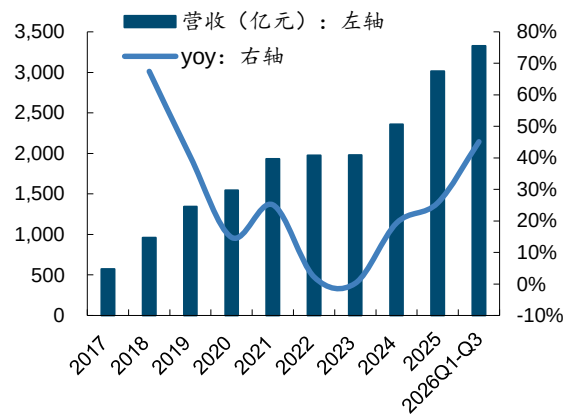
图表43：元件行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

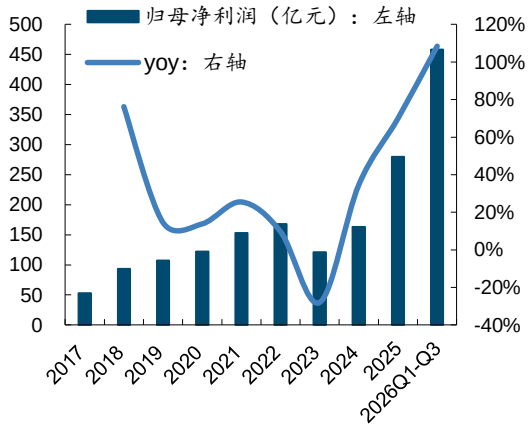
PCB 行业 2026 年前三季度实现营收 3324.60 亿元，同增 45.09%，归母净利润 458.32 亿元，同增 108.42%。其中，2026Q3 实现营收 1463.39 亿元，同增 85.40%，环增 41.27%；归母净利润 240.94 亿元，同增 196.00%，环增 75.56%。受全球 AI 算力基础设施持续高景气驱动，AI 服务器、交换机及高速互联相关 PCB 需求快速增长，高多层板、高阶 HDI 及低损耗材料需求持续放量。随着新一代 GPU 平台及北美云厂商 ASIC 方案进入规模化部署阶段，单机柜 PCB 用量与价值量继续提升，头部厂商高端产能维持高稼动率。同时，封装基板需求随半导体景气回升逐步改善。

图表44：PCB行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

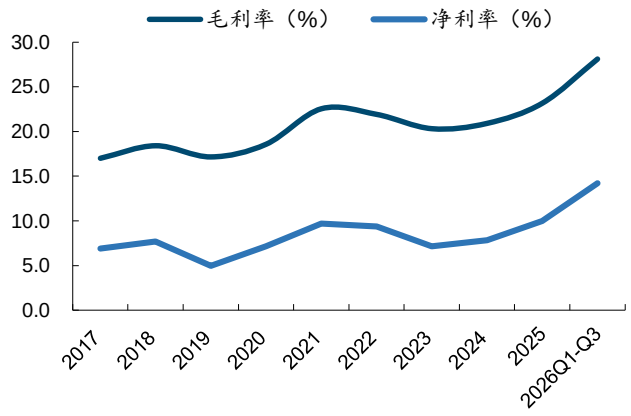
图表45：PCB行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

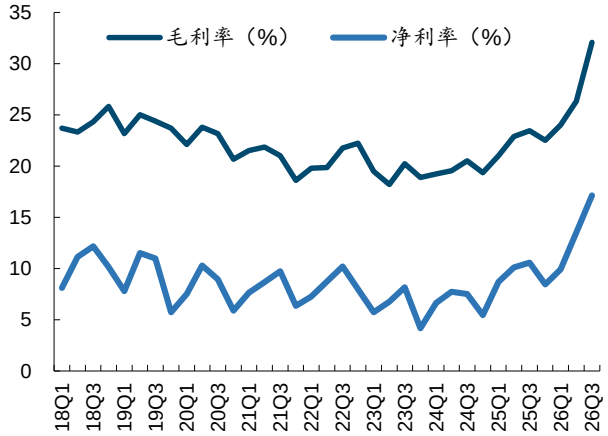
PCB行业盈利能力持续提升。2026年前三季度毛利率为28.1%，净利率为14.1%。26Q3毛利率为32.1%，同比+8.6pct，环比+5.8pct；净利率为17.1%，同比+6.6pct，环比+3.6pct。

图表46：PCB行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表47：PCB行业单季度历史盈利能力情况

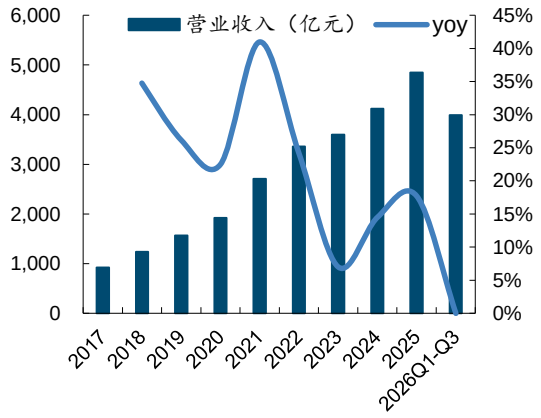


来源：wind、国金证券研究所

2.5：汽车电子：2026Q1-Q3营收同增19.65%，26Q1-Q3归母净利同比-7.15%

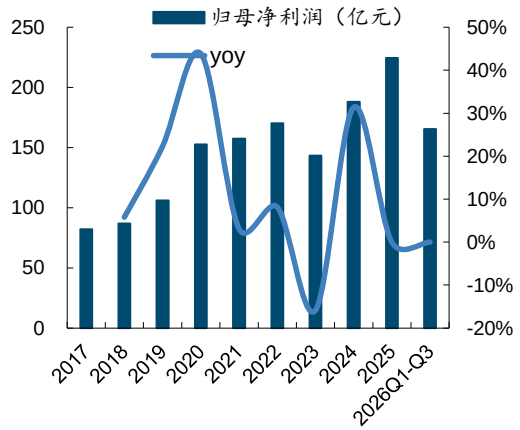
汽车电子板块2026年前三季度实现营收3988.90亿元，同增19.65%，归母净利润165.45亿元，同比-7.15%。其中，2026Q3实现营收1508.05亿元，同增11.22%，环增15.93%；归母净利润64.52亿元，同比-7.17%，环增20.60%。随着新能源汽车行业由高速增长逐步转向稳健增长，汽车电子需求增速有所分化，但800V高压平台、快充、智能驾驶及座舱电子渗透率持续提升，仍带动功率器件、连接器、传感器及控制器等环节需求增长。整体来看，前三季度板块收入维持增长，但利润端仍受价格竞争、部分环节降价压力及成本端扰动影响，同比有所承压；单季度看，Q3利润环比出现一定修复，但同比仍未转正。

图表48：汽车电子行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

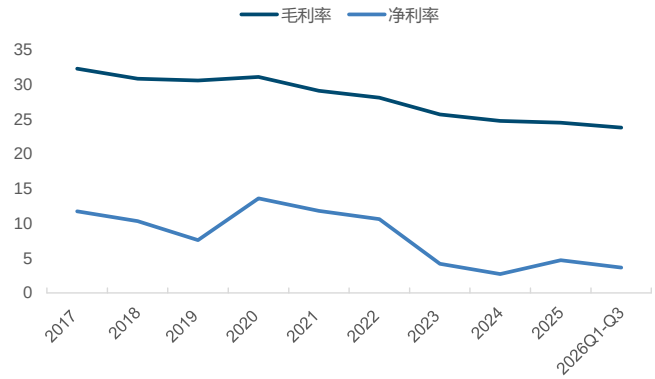
图表49：汽车电子行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

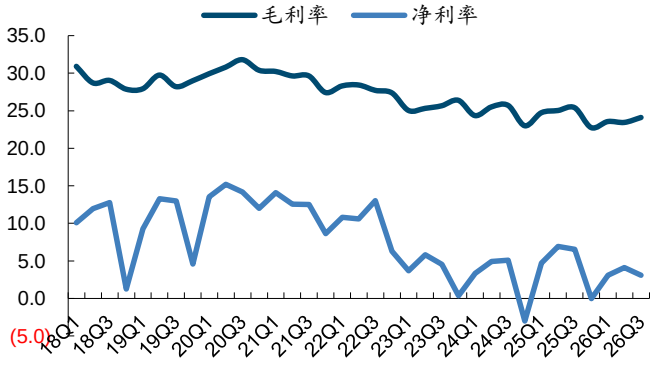
盈利能力仍有所承压。汽车电子行业 2026 年前三季度毛利率为 23.8%，净利率为 3.7%。26Q3 毛利率为 24.1%，同比-1.3pct，环比+0.7pct；净利率为 3.1%，同比-3.4pct，环比-1.0pct。

图表50：汽车电子行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表51：汽车电子行业单季度历史盈利能力情况

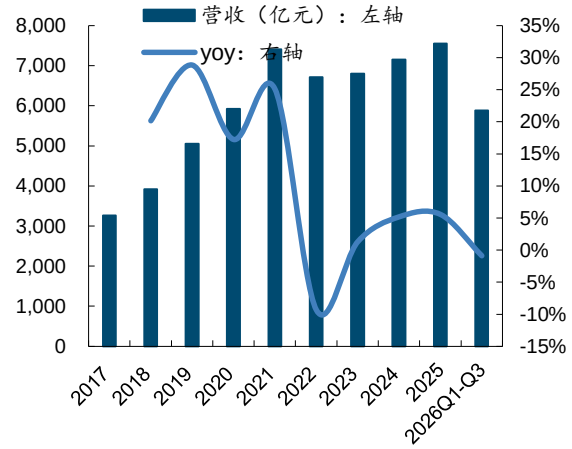


来源：wind、国金证券研究所

2.6：光学光电子：2026Q1-Q3 营收同比-0.88%，26Q1-Q3 归母净利同比-27.56%

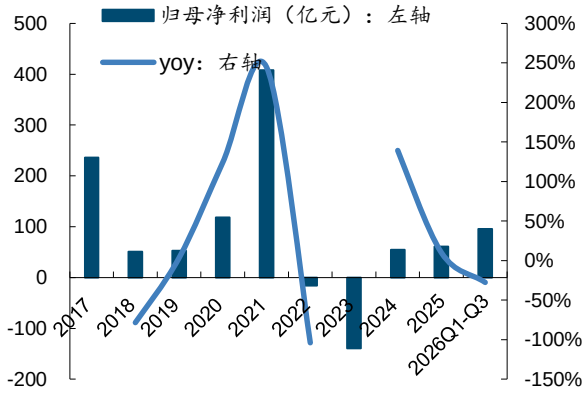
光学光电子行业 2026 年前三季度实现营收 5881.17 亿元，同比-0.88%，归母净利润 95.29 亿元，同比-27.56%。其中，2026Q3 实现营收 2212.32 亿元，同增 12.02%，环增 16.24%；归母净利润 18.89 亿元，同减 39.84%，环降 61.37%。前三季度板块收入整体表现相对平稳，显示面板、LED 及传统光学业务需求总体稳定，同时 AI 服务器高速光模块、光通信器件及部分高端光学产品需求增长，对收入端形成一定支撑。

图表52：光学光电子行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

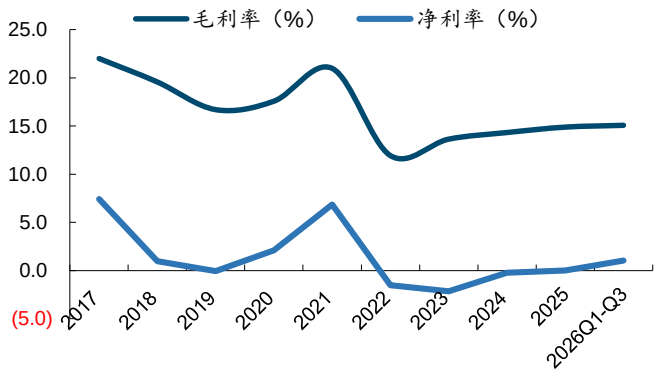
图表53：光学光电子行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

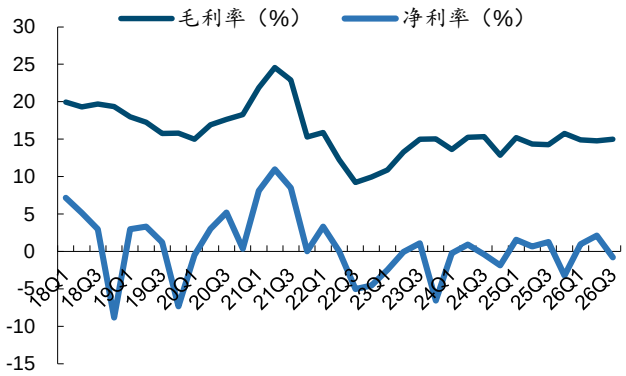
盈利能力有所承压。光学光电子行业 2026 年前三季度毛利率为 15.1%，净利率为 1.0%。26Q3 毛利率为 15.0%，同比+0.7pct，环比+0.2pct；净利率为-0.8%，同比-2.0pct，环比-2.9pct

图表54：光学光电子行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表55：光学光电子行业单季度历史盈利能力情况

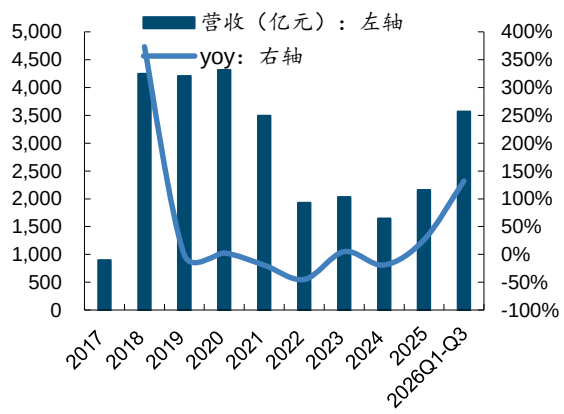


来源：wind、国金证券研究所

2.7：其他电子：2026Q1-Q3 营收同增 132.08%，26Q1-Q3 归母净利同增 152.38%

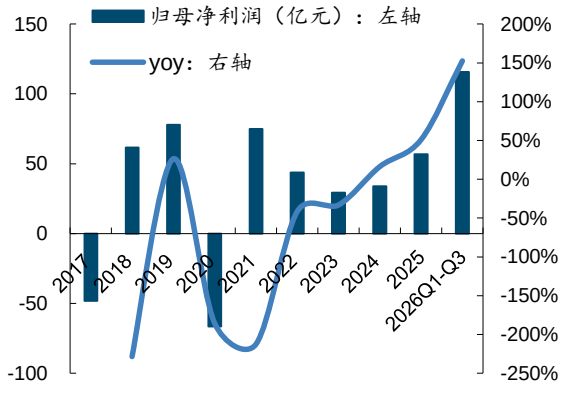
其他电子行业 2026 年前三季度实现营收 3568.94 亿元，同增 132.08%，归母净利润 115.60 亿元，同增 152.38%。其中，2026Q3 实现营收 1485.66 亿元，同增 166.10%，环增 21.68%；归母净利润 42.39 亿元，同增 160.06%，环降 4.29%。前三季度板块收入与利润均维持高速增长，主要受部分高景气细分方向持续放量及低基数影响。随着 AI 硬件、精密制造及相关新兴电子应用需求增长，板块景气度维持较高水平。单季度来看，Q3 收入继续较快增长，利润同比仍保持高增，但较 Q2 小幅回落。

图表56：其他电子行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

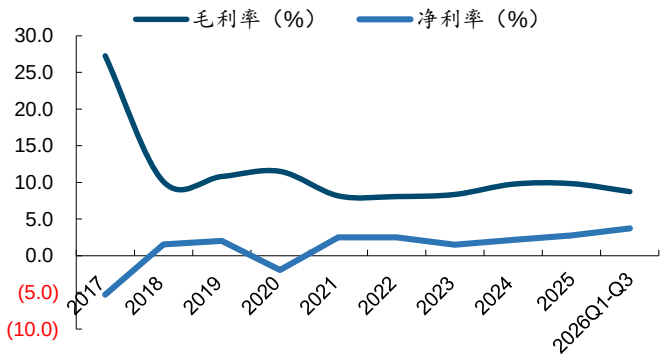
图表57：其他电子行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

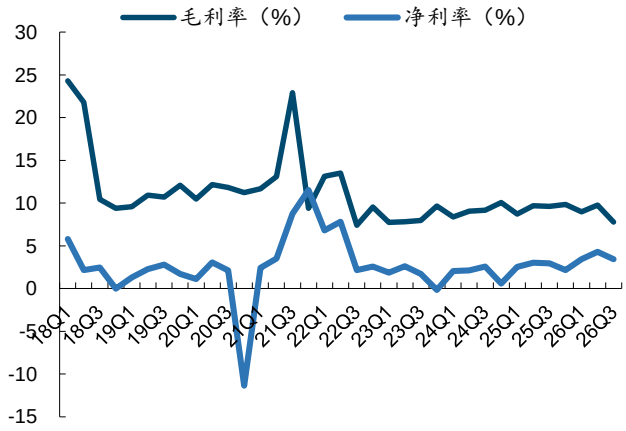
盈利能力小幅承压。其他电子行业2026年前三季度毛利率为8.7%，净利率为3.7%。26Q3毛利率为7.8%，同比-1.9pct，环比-2.0pct；净利率为3.4%，同比+0.5pct，环比-0.9pct。

图表58：其他电子行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表59：其他电子行业单季度历史盈利能力情况



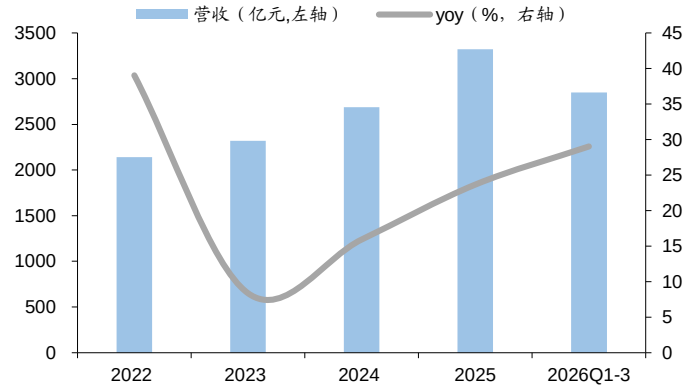
来源：wind、国金证券研究所

三、龙头表现：AI 硬件产业链公司业绩亮眼

3.1：消费电子

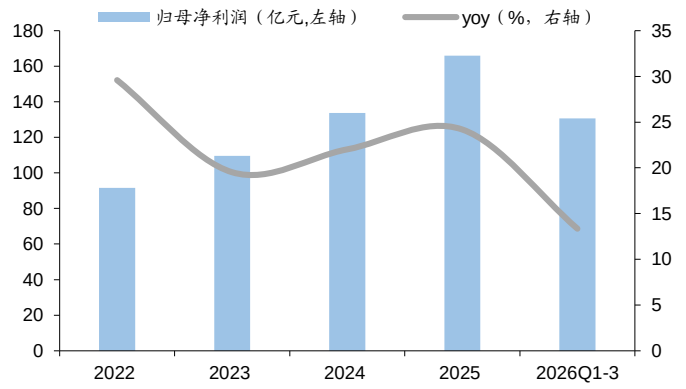
立讯精密：2026 年前三季度实现营收 2850.12 亿元，同比+29.01%；归母净利润 130.57 亿元，同比+13.36%；扣非归母净利润 103.74 亿元，同比+8.72%。2026Q3 单季度营收 1105.07 亿元，同比+14.62%；归母净利润 52.14 亿元，同比+6.98%；扣非归母净利润 44.12 亿元，同比+11.91%。公司作为全球精密智造龙头，消费电子业务围绕核心客户新品推进协同交付，通信与数据中心高速铜缆、光模块等产品加快量产，汽车电子则受莱尼并表及业务整合拉动，前三季度收入增速明显快于归母利润，主要受人民币升值、原材料和要素成本上涨，以及融资利息、汇兑损失增加影响，整体来看，公司多元业务持续贡献增量，Q4 重点关注消费电子旺季交付、数据中心新品规模化出货及莱尼整合后的经营效率改善。

图表60：立讯精密营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

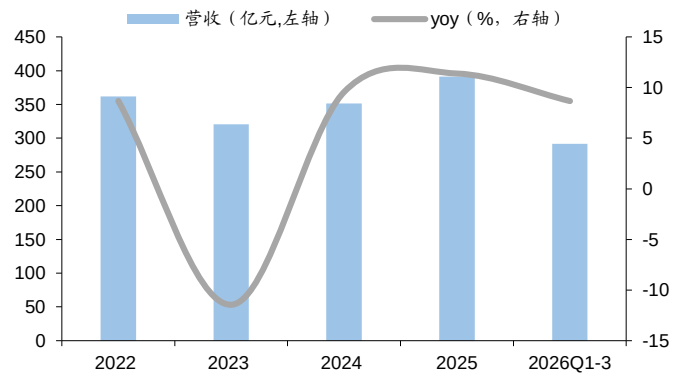
图表61：立讯精密归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

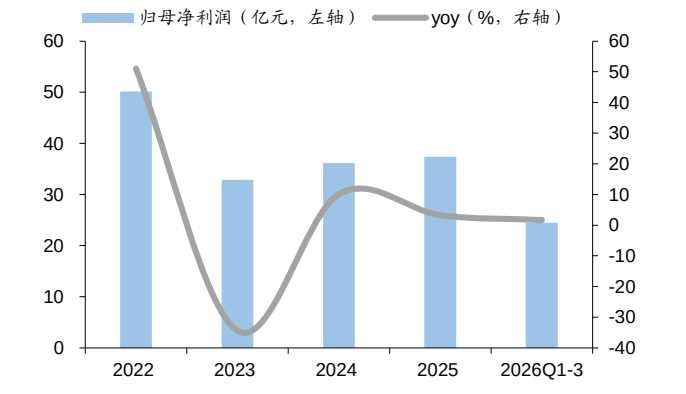
鹏鼎控股：2026 年前三季度实现营收 291.87 亿元，同比+8.68%；归母净利润 24.48 亿元，同比+1.68%；扣非归母净利润 21.04 亿元，同比-6.26%。2026Q3 单季度营收 119.70 亿元，同比+14.21%；归母净利润 11.64 亿元，同比-0.87%；扣非归母净利润 12.12 亿元，同比+10.56%。公司作为全球 PCB 龙头及消费电子 FPC 领先厂商，持续推进 AI 服务器、光模块等高端 PCB 业务，前三季度汽车及服务器用板收入同比+209.05%，毛利率提升至 41.92%，Q3 单季收入达 20.40 亿元，成为主要增长来源；传统消费电子及计算机用板收入同比[illegible]。盈利端受前置研发及汇兑损失拖累，前三季度研发费用 25.89 亿元，同比+51.17%，主要投向 AI 高速板、汽车高端板等新工艺及产品认证；汇兑损失 6.29 亿元，同比增加 5.78 亿元。高端产品放量推动收入增长，但研发投入和汇兑扰动压制当期利润。后续随着新产能释放及高端产品量产，盈利能力有望逐步改善。

图表62：鹏鼎控股营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表63：鹏鼎控股归母净利润情况

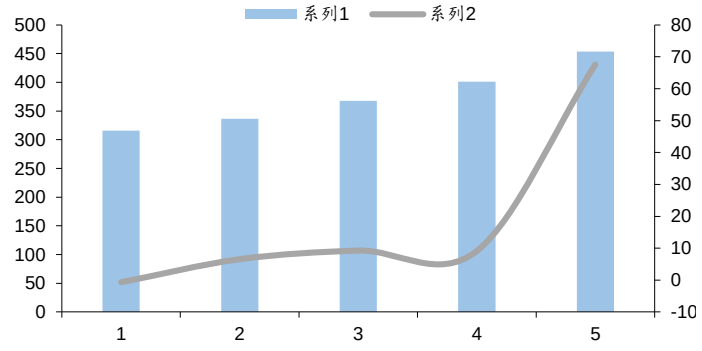


来源：ifind，国金证券研究所

东山精密：2026 年前三季度实现营收 453.79 亿元，同比+67.63%；归母净利润 52.89 亿元，同比+332.34%；扣非归母净利润 45.79 亿元，同比+327.48%。2026Q3 单季度营收 175.82 亿元，同比+73.81%；归母净利润 23.32 亿元，同比+401.18%；扣非归母净利润 20.99 亿元，同比+406.69%。公司以精密组件、PCB 及光通信业务为核心，索尔思光电与 GMD 并表贡献重要收入增量，AI 数据中心需求旺盛推动高速光模块出货增长，光通信业务成为新的利润增长点；同时公司持续推进高端 PCB 产能建设及高速光芯片研发，强化 AI 算力产业链布局。Q3 扣非利润增速显著高于收入，新增高附加值业务对盈利的贡献逐步体现。10 月公司完成 H 股上市，进一步拓宽融资渠道，1.6T 光模块于 Q4 进入批量出货阶段。随着高速光模块交付规模扩大及高端 PCB 产品持续升级，公司 AI 算力业务有望进一步贡献业绩增量，后续

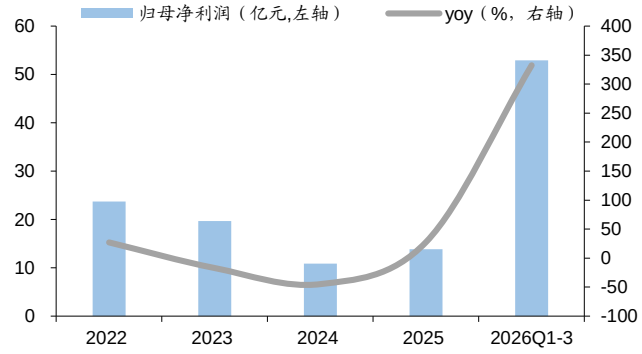
重点关注 1.6T 产品放量及并购业务整合成效。

图表64：东山精密营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

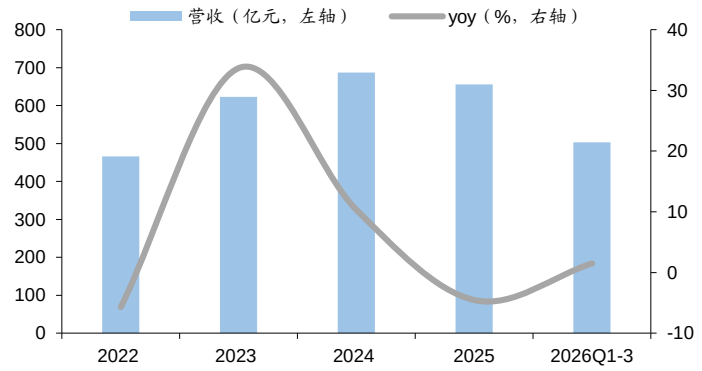
图表65：东山精密归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

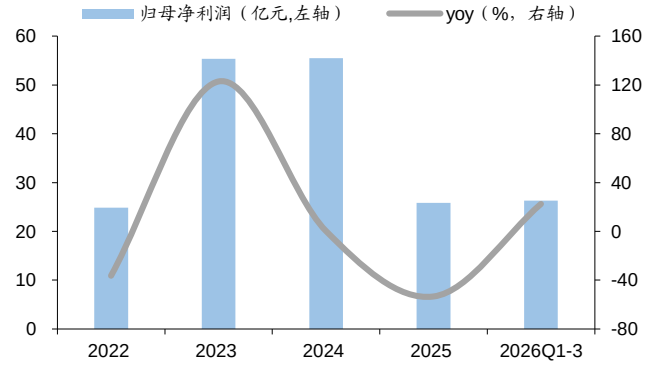
传音控股：2026 年前三季度实现营收 502.80 亿元，同比+1.49%；归母净利润 26.30 亿元，同比+22.44%；扣非归母净利润 19.16 亿元，同比+10.70%。2026Q3 单季度营收 148.49 亿元，同比-27.45%；归母净利润 8.57 亿元，同比-8.40%；扣非归母净利润 4.36 亿元，同比-47.72%。公司深耕非洲、南亚等新兴市场，上半年通过产品提价及前期低成本库存消化实现盈利改善，但 Q3 受终端市场需求走弱、存储成本上涨影响，收入及扣非利润明显下滑；单季非经常性损益达 4.21 亿元，对归母利润形成支撑。存储涨价推动公司增加备货，前三季度经营现金流净额为-98.73 亿元，期末存货增至 173.19 亿元。公司 10 月完成 H 股上市，进一步拓宽融资渠道。短期存储涨价与终端需求疲软仍将制约盈利修复，预计 Q4 业绩仍面临压力；中长期依托新兴市场渠道优势及智能机升级需求，成本顺价与产品结构改善有望逐步推动利润修复。

图表66：传音控股营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

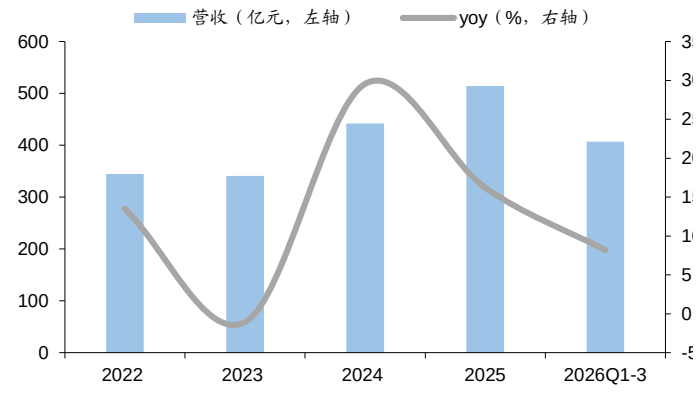
图表67：传音控股归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

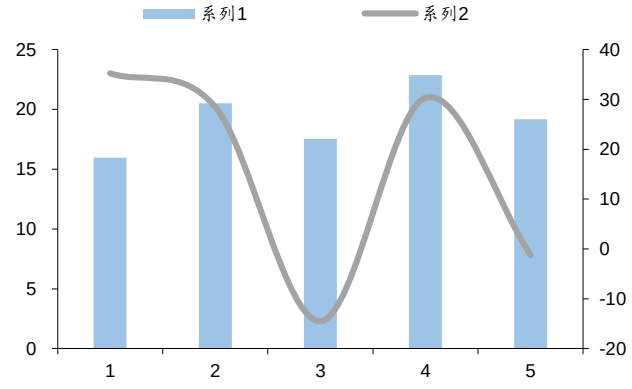
领益智造：2026 年前三季度实现营收 406.71 亿元，同比+8.20%；归母净利润 19.17 亿元，同比-1.27%；扣非归母净利润 14.47 亿元，同比-3.77%。2026Q3 单季度营收 155.22 亿元，同比+11.15%；归母净利润 11.53 亿元，同比+14.00%；扣非归母净利润 10.58 亿元，同比+17.88%。公司作为消费电子精密功能件及结构件龙头，受益北美大客户新品交付及高附加值产品放量，Q3 营收及利润均创单季新高。苹果首款折叠屏 iPhoneDuo 业务覆盖铰链结构件、屏幕支撑板、超薄 VC 及电池钢壳等，单机价值量为传统直板机的数倍，三四季度持续推进量产交付；AI 服务器液冷、电源业务同步拓展。前三季度毛利率同比提升 1.70pct，但研发费用同比+25.72%至 22.44 亿元，叠加汇兑波动影响，累计利润仍有所承压。随着折叠屏新品交付及高价值量零部件渗透，公司消费电子业务盈利能力有望进一步提升，液冷及服务器电源业务放量有望贡献新增量。

图表68：领益智造营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

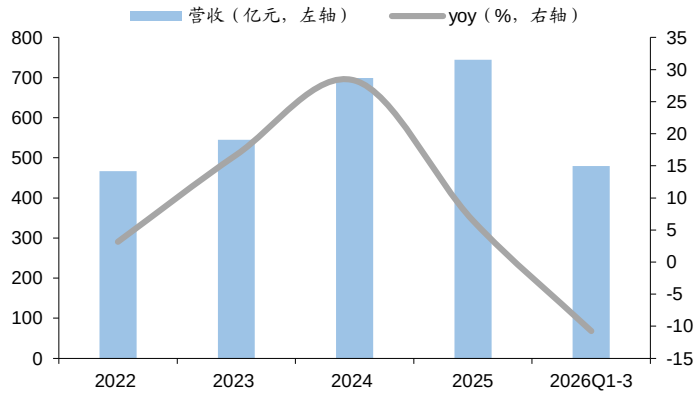
图表69：领益智造归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

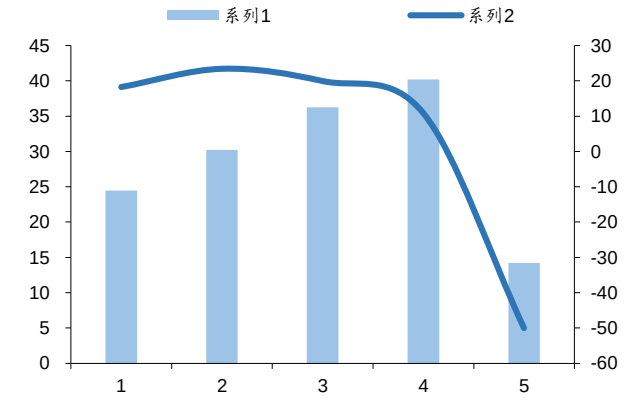
蓝思科技：2026 年前三季度实现营收 479.02 亿元，同比-10.74%；归母净利润 14.20 亿元，同比-50.06%；扣非归母净利润 9.98 亿元，同比-63.07%。2026Q3 单季度营收 190.35 亿元，同比-8.05%；归母净利润 8.43 亿元，同比-50.42%；扣非归母净利润 7.20 亿元，同比-59.13%。公司作为消费电子玻璃及结构件龙头，受存储涨价抑制终端需求、北美大客户新品发布节奏调整影响，结构件及组装业务收入承压。前三季度汇兑损失 6.54 亿元，较去年同期汇兑收益减少 7.69 亿元，叠加收入下滑导致毛利润减少约 7 亿元，拖累盈利表现；Q3 研发费用同比+18.7%至 9.45 亿元，主要投向客户新品验证及新兴业务。公司持续拓展折叠屏玻璃、AI 眼镜、机器人及服务器液冷等高附加值业务。随着客户延后新品逐步交付及 2027 年终端创新周期启动，传统业务收入与产能利用率有望回升，新业务规模化交付将进一步支撑盈利修复。

图表70：蓝思科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表71：蓝思科技归母净利润情况

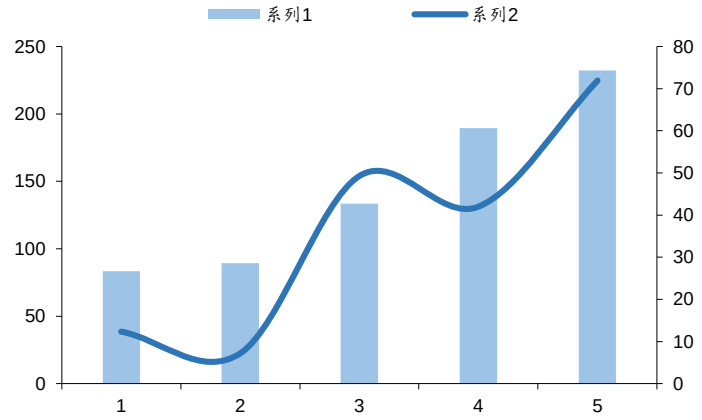


来源：ifind，国金证券研究所

3.2：PCB

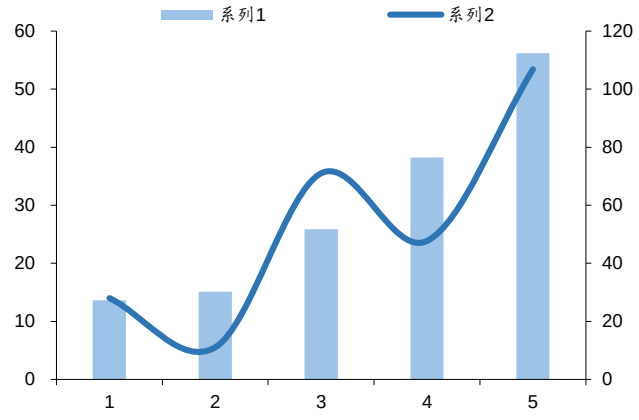
沪电股份：2026 年前三季度实现营收 232.25 亿元，同比+71.88%；归母净利润 56.22 亿元，同比+106.87%；扣非归母净利润 54.74 亿元，同比+104.53%。2026Q3 单季度营收 95.36 亿元，同比+90.02%；归母净利润 26.99 亿元，同比+160.77%；扣非归母净利润 26.80 亿元，同比+159.50%。公司作为全球高端 PCB 龙头，持续受益 AI 服务器、高速交换机及 HPC 需求增长，其中高速交换机及配套路由为主要增长来源，上半年相关收入达 71.39 亿元。产品端，1.6T 交换机用板已实现批量出货，适配 224Gbps 传输速率的产品进入小批量供货阶段，3.2T 交换机及 448Gbps 相关产品推进前瞻研发。高端产品占比提升叠加规模效应，推动 Q3 利润增速显著高于营收；泰国基地由产能爬坡转入规模化运营，前三季度实现扭亏为盈。随着下一代交换机平台升级及泰国产能持续释放，公司高端 PCB 业务有望延续较快增长，产品结构优化进一步支撑盈利能力提升。

图表72：沪电股份营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

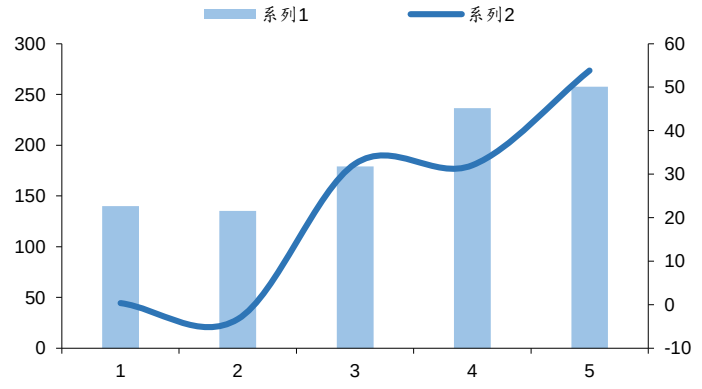
图表73：沪电股份归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

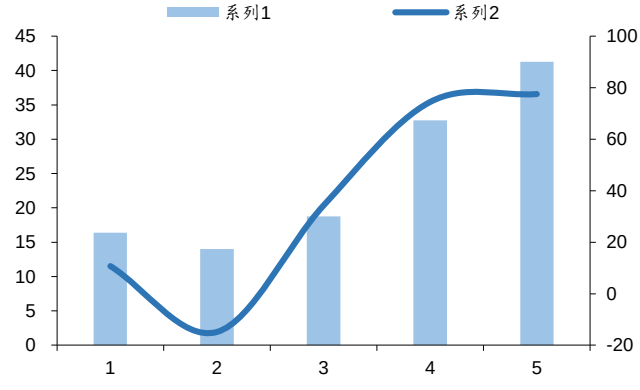
深南电路：2026 年前三季度实现营收 257.74 亿元，同比+53.84%；归母净利润 41.29 亿元，同比+77.54%；扣非归母净利润 40.98 亿元，同比+87.80%。2026Q3 单季度营收 104.78 亿元，同比+66.29%；归母净利润 18.78 亿元，同比+94.42%；扣非归母净利润 18.58 亿元，同比+102.78%。公司作为国内 PCB 及封装基板龙头，持续受益 AI 算力基础设施建设，AI 加速卡、服务器、高速交换机及光模块用板需求旺盛，数据中心 PCB 收入占比持续提升；封装基板业务方面，存储、PMIC 及应用处理器类产品订单快速释放，带动产品结构及毛利率改善。广州封装基板项目稳步爬坡，FC-BGA 已具备 26 层及以下产品批量生产能力，30 层及以上产品推进研发打样；南通四期及泰国工厂产能同步释放，推动 Q3 盈利增速显著高于营收。随着高阶 PCB 需求延续及封装基板产能利用率提升，双主业有望继续释放增长动能，产品结构升级进一步支撑盈利能力提升。

图表74：深南电路营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

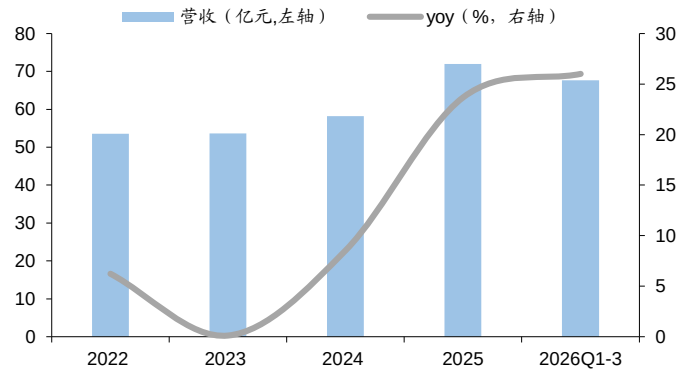
图表75：深南电路归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

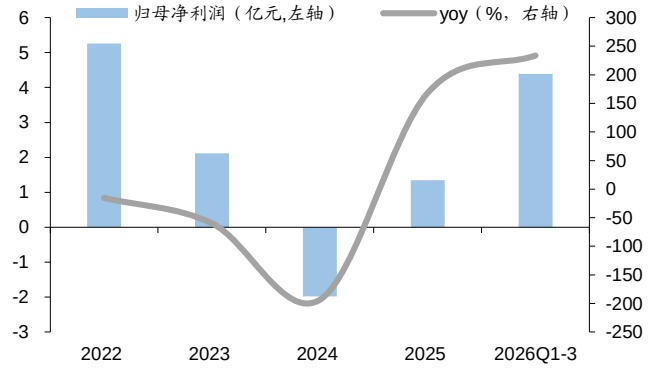
兴森科技：2026 年前三季度实现营收 67.70 亿元，同比+26.00%；归母净利润 4.39 亿元，同比+233.70%；扣非归母净利润 4.57 亿元，同比+207.35%。2026Q3 单季度营收 27.32 亿元，同比+40.32%；归母净利润 3.28 亿元，同比+219.77%；扣非归母净利润 3.32 亿元，同比+225.89%。公司作为国内 PCB 及 IC 封装基板领先厂商，受益 AI 算力及存储需求增长，CSP 封装基板订单饱满、量价齐升，光模块 mSAP 基板实现行业一线客户突破，良率及交付保持较高水平，已贡献较大收入及利润增量；宜兴硅谷通过产品结构调整、价格提升及降本增效实现扭亏，带动 Q3 盈利能力显著提升。随着 CSP 及光模块基板订单持续释放，公司主业盈利能力有望进一步增强，FC-BGA 客户验证向批量订单转化将打开中长期成长空间。

图表76：兴森科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

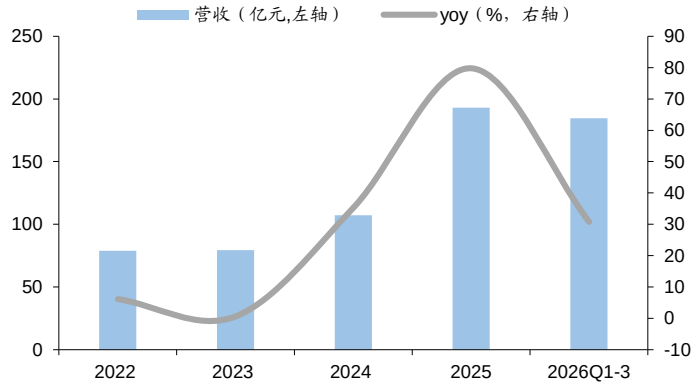
图表77：兴森科技归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

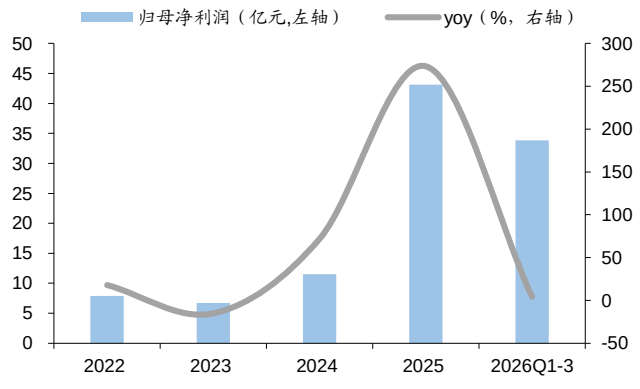
胜宏科技：2026 年前三季度实现营收 184.61 亿元，同比+30.77%；归母净利润 33.84 亿元，同比+4.28%；扣非归母净利润 36.94 亿元，同比+13.74%。2026Q3 单季度营收 68.31 亿元，同比+34.30%；归母净利润 5.27 亿元，同比-52.17%；扣非归母净利润 12.76 亿元，同比+16.16%。公司作为全球高端 PCB 龙头，持续受益 AI 算力需求增长，前三季度 AI 相关业务收入占比约 40%，Q3 网络通信业务增长明显，主要受益 1.6T 光模块 mSAP 产品放量。Q3 毛利率环比提升 2.06pct 至 34.17%，主要受产品价格上涨带动；但金融资产公允价值变动及处置损失约 6.90 亿元，导致归母利润明显低于扣非利润。公司 AI 业务订单饱满，新一代产品复杂度及生产周期提升带动在制品库存增加，持续推进高阶 HDI 产能建设。随着 1.6T 光模块 PCB 持续放量及新一代算力平台产品交付，公司高端 PCB 业务有望保持增长，新增产能释放及产品结构升级将进一步支撑盈利能力改善。

图表78：胜宏科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

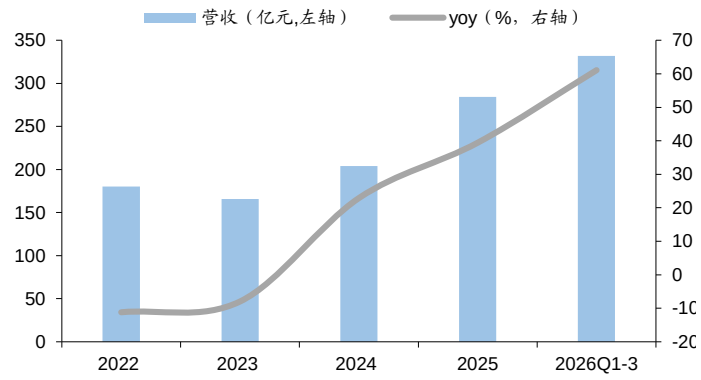
图表79：胜宏科技归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

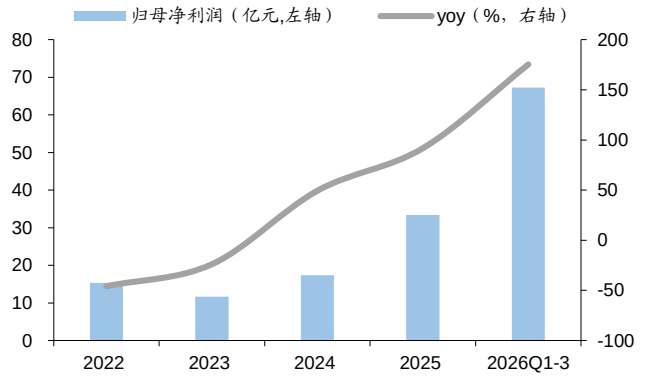
生益科技：2026 年前三季度实现营收 332.08 亿元，同比+61.10%；归母净利润 67.27 亿元，同比+175.36%；扣非归母净利润 63.79 亿元，同比+168.10%。2026Q3 单季度营收 141.82 亿元，同比+78.76%；归母净利润 34.40 亿元，同比+238.40%；扣非归母净利润 34.72 亿元，同比+246.70%。公司作为全球覆铜板龙头，持续受益 AI 服务器、高速交换机等高端需求增长，前期研发的高速高频材料加速商业化，叠加新增产能及时释放，带动覆铜板销量及高端产品占比同步提升；同时通过产品价格调整应对原材料上涨，前三季度综合毛利率同比提升 6.54pct 至 35.36%，盈利能力显著增强。子公司生益电子受益 AI 算力高景气，高附加值 PCB 产品占比持续提升，推动线路板业务收入及利润增长。前三季度经营现金流净额达 60.66 亿元，同比+90.99%，经营质量同步改善。随着高端材料需求持续增长及新增产能释放，公司覆铜板业务有望延续量价改善，高端 PCB 放量进一步增强盈利弹性。

图表80：生益科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

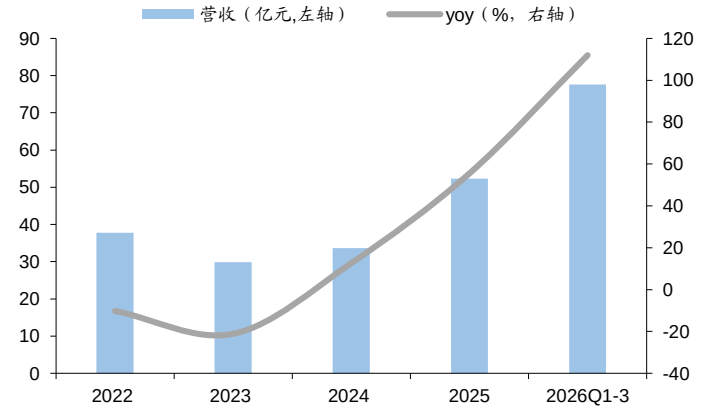
图表81：生益科技归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

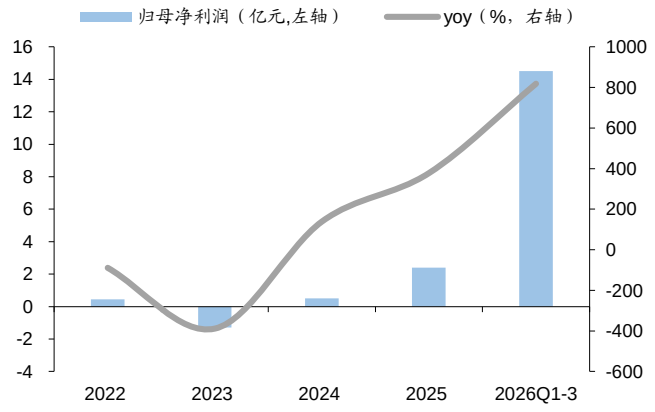
南亚新材：2026 年前三季度实现营收 77.64 亿元，同比+111.93%；归母净利润 14.51 亿元，同比+817.72%；扣非归母净利润 14.38 亿元，同比+898.48%。2026Q3 单季度营收 35.40 亿元，同比+160.62%；归母净利润 9.90 亿元，同比+1295.94%；扣非归母净利润 9.85 亿元，同比+1468.41%。公司作为国内高端覆铜板领先厂商，持续受益 AI 服务器、高速交换机等算力需求增长，高频高速材料订单旺盛，主要产品销量及售价同步提升，叠加高附加值产品占比增加，Q3 单季毛利率提升至约 38.08%，归母利润环比+218%，盈利弹性加速释放。公司 10 月完成 7.40 亿元募集资金增资江苏南亚，推进面向 AI 算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目，进一步扩充高端产能。前三季度经营现金流净额为-1.00 亿元，主要受采购及税费支出增加影响。随着高端材料需求持续增长及新增产能逐步落地，公司产品量价改善有望延续，利润增长将进一步受益于高端产品结构升级及规模效应。

图表82：南亚新材营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

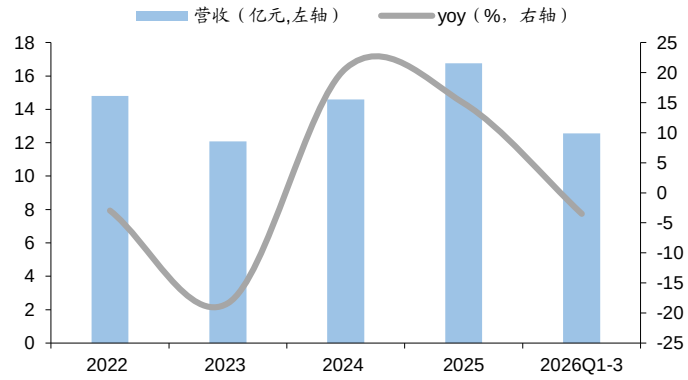
图表83：南亚新材归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

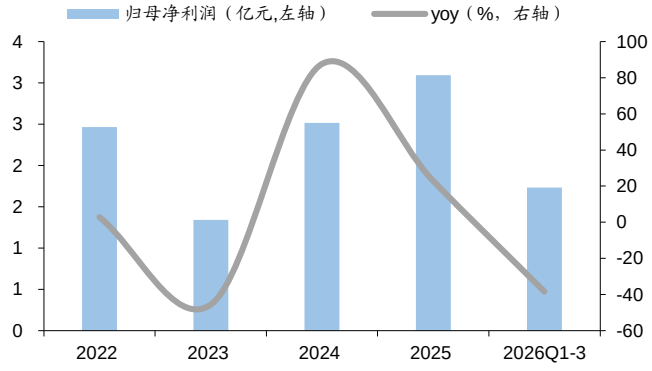
瑞联新材：2026 年前三季度实现营收 12.56 亿元，同比-3.50%；归母净利润 1.73 亿元，同比-38.35%；扣非归母净利润 1.62 亿元，同比-41.40%。2026Q3 单季度营收 4.31 亿元，同比-12.90%；归母净利润 0.44 亿元，同比-61.59%；扣非归母净利润 0.41 亿元，同比-63.95%。公司以 OLED 显示材料、医药中间体及半导体电子材料为主要业务，受下游面板厂商控产及采购节奏放缓影响，显示材料业务承压；人民币升值导致外销收入减少，叠加原材料及人工成本上涨、显示材料订单小批量多批次增加，Q3 单季毛利率降至 35.84%，盈利降幅明显大于收入。新业务方面，公司 8 月与 TCL 华星旗下华星印刷签署技术许可协议，共同开发印刷 OLED 终端材料，部分产品已完成研发并送样，后续有望配套其 8.6 代印刷 OLED 产线。短期公司盈利仍受显示材料需求及成本压力制约，随着产品结构优化和订单规模恢复，盈利能力有望逐步修复；印刷 OLED 材料将为中长期业务拓展提供新增量。

图表84：瑞联新材营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表85：瑞联新材归母净利润情况

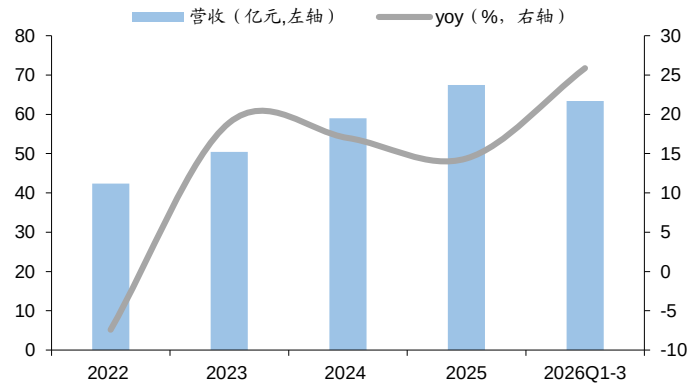


来源：ifind，国金证券研究所

3.3：被动元件

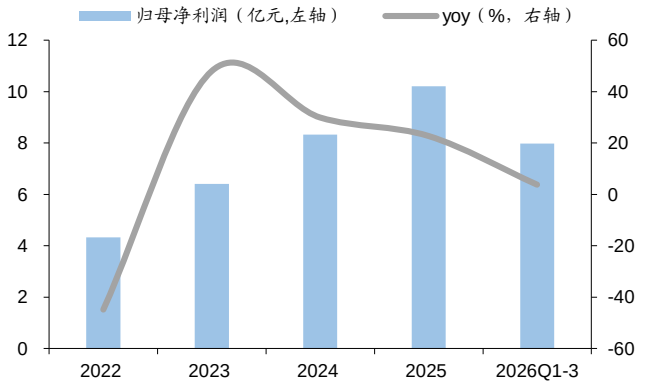
顺络电子：2026 年前三季度实现营收 63.34 亿元，同比+25.87%；归母净利润 7.98 亿元，同比+3.79%；扣非归母净利润 7.79 亿元，同比+6.28%。2026Q3 单季度营收 24.76 亿元，同比+36.94%；归母净利润 3.51 亿元，同比+23.97%；扣非归母净利润 3.46 亿元，同比+27.62%。公司作为国内电感及磁性元件龙头，持续受益 AI 数据中心、汽车电子及储能需求增长，前三季度汽车电子或储能专用元件收入 14.86 亿元，同比+40.99%。AI 服务器双相 TLVR 电感已实现批量出货，Q3 交付明显增长，四相 TLVR 预计 2027H2 开始量产；光模块磁珠受海外供应商交付紧张影响，承接部分外溢订单，推动信号处理业务增长。受金属原材料涨价及人工成本上升影响，Q3 毛利率同比-1.60pct 至 35.24%，但环比提升 0.83pct。随着 AI 电感产品升级及光通信业务放量，公司高附加值产品收入占比有望进一步提升，叠加原材料成本传导逐步落地，盈利能力有望持续修复。

图表86：顺络电子营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

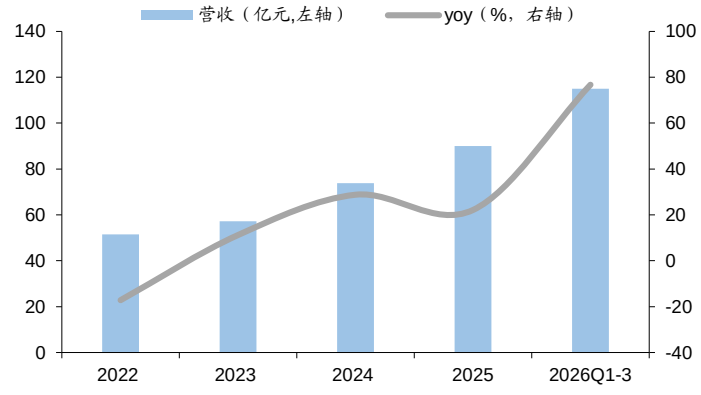
图表87：顺络电子归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

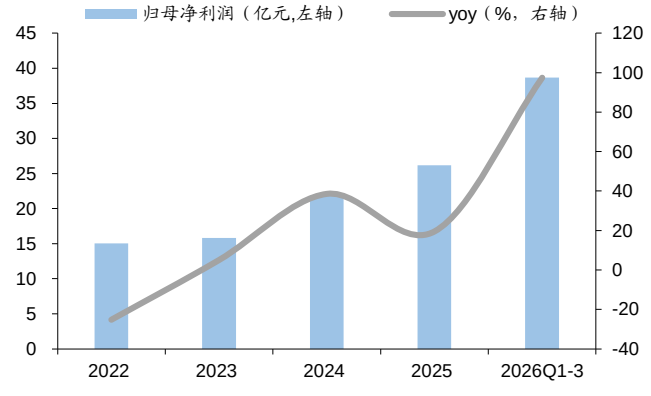
三环集团：2026 年前三季度实现营收 115.03 亿元，同比+76.74%；归母净利润 38.65 亿元，同比+97.35%；扣非归母净利润 36.82 亿元，同比+115.76%。2026Q3 单季度营收 50.79 亿元，同比+115.27%；归母净利润 19.33 亿元，同比+167.97%；扣非归母净利润 18.72 亿元，同比+192.61%。公司作为国内 MLCC 及电子陶瓷龙头，持续受益 AI 数据中心、汽车电子及光通信需求增长，MLCC 客户认可度提升，部分规格产品价格修复，销量及销售额显著增长；全球数据中心建设带动陶瓷插芯、套筒等通信元件需求提升。前三季度公司订单饱满，部分主营产品量价齐升，叠加规模效应推动 Q3 毛利率环比+8.81pct 至 53.72%，盈利能力显著增强；经营现金流净额 34.27 亿元，同比+72.18%。随着 MLCC 高端产品需求增长及光通信元件订单持续释放，公司产品结构有望进一步升级，量价改善与产能扩张共同支撑业绩增长。

图表88：三环集团营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

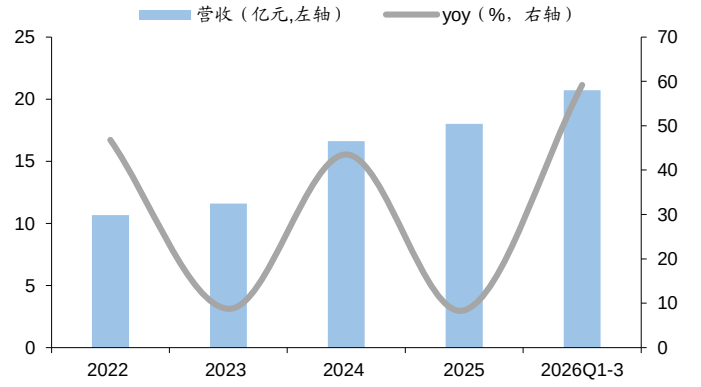
图表89：三环集团归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

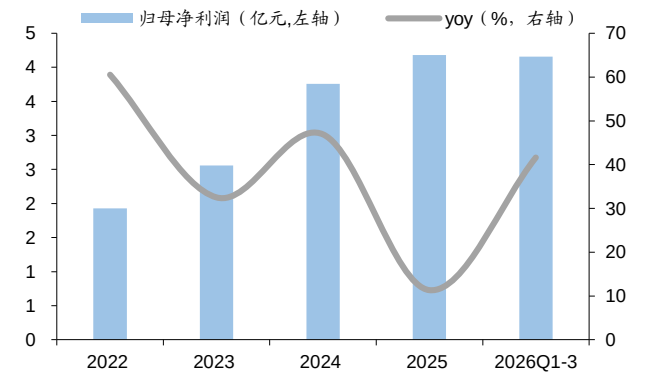
铂科新材：2026 年前三季度实现营收 20.71 亿元，同比+59.21%；归母净利润 4.16 亿元，同比+41.60%；扣非归母净利润 4.13 亿元，同比+42.91%。2026Q3 单季度营收 8.88 亿元，同比+101.74%；归母净利润 1.90 亿元，同比+85.81%；扣非归母净利润 1.90 亿元，同比+88.08%。公司作为国内金属软磁材料及 AI 芯片电感龙头，受益全球云厂商资本开支增长及 ASIC 供电架构升级，模块化电感、TLVR 电感需求快速释放，2026H1 TLVR 占 AI 芯片电感收入比例已超过 30%。9 月公告披露芯片电感在手订单同比增长约 400%，惠东一期新型一体成型电感项目已投入规模化生产，规划达产产能约 2 亿颗/年，后续产能爬坡有望缓解交付瓶颈。前三季度研发费用同比+93.35%，叠加管理费用及汇兑损失增加，利润增速低于收入。随着新增产能释放及 TLVR 等高价值量产品占比提升，公司芯片电感业务有望延续较快增长，规模效应将进一步改善盈利能力。

图表90：铂科新材营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

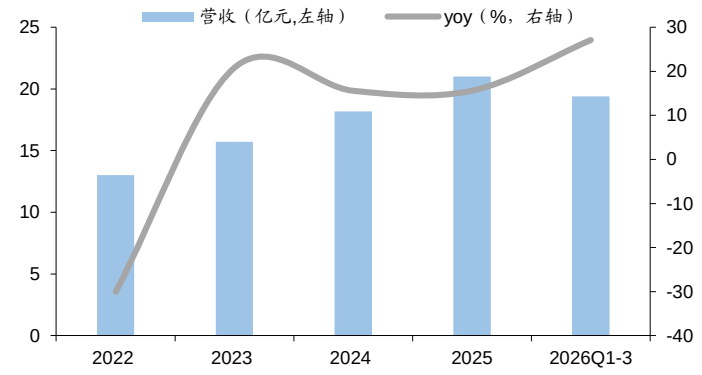
图表91：铂科新材归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

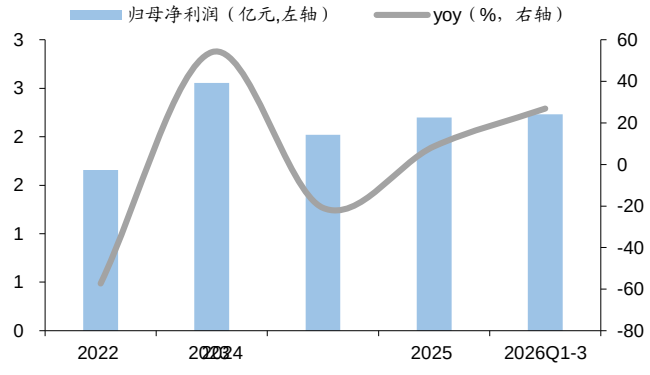
洁美科技：2026 年前三季度实现营收 19.40 亿元，同比+27.10%；归母净利润 2.23 亿元，同比+26.93%；扣非归母净利润 1.86 亿元，同比+9.07%。2026Q3 单季度营收 7.71 亿元，同比+36.80%；归母净利润 0.86 亿元，同比+10.46%；扣非归母净利润 0.85 亿元，同比+12.35%。公司作为电子封装载带及 MLCC 离型膜龙头，受益电子元器件小型化、车载及半导体需求增长，纸质、塑料载带业务稳步扩张；电子级薄膜材料加速放量，2026H1 收入同比+78.99%，高端 MLCC 离型膜已进入国内外主要客户供应链，1.6μm 及 1.0μm 涂层产品实现批量应用。公司 10 月公告离型膜出货持续增长，现有产能已达上限，拟投资 26.84 亿元新建年产 4 万吨光学级 BOPET 膜及 7.68 亿平方米高端离型膜项目，进一步强化基膜自供及高端产品配套能力。受市场拓展、汇兑损失及新增产能折旧等因素影响，Q3 利润增速仍低于营收。随着高端离型膜订单持续释放及一体化产能布局完善，公司薄膜材料收入占比有望继续提升，产能瓶颈缓解与规模效应将逐步推动盈利能力改善。

图表92：洁美科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表93：洁美科技归母净利润情况

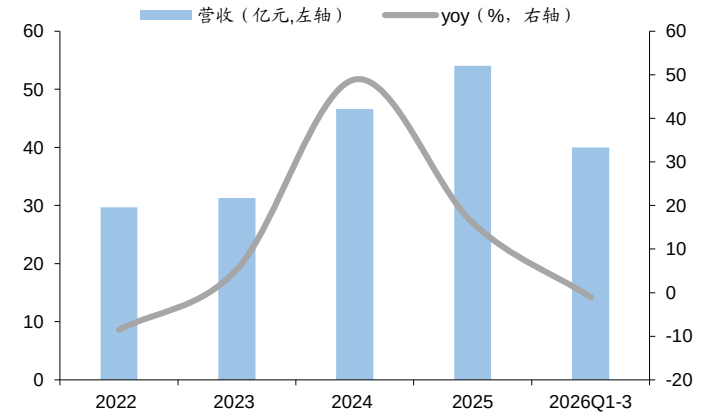


来源：ifind，国金证券研究所

3.4：汽车电子

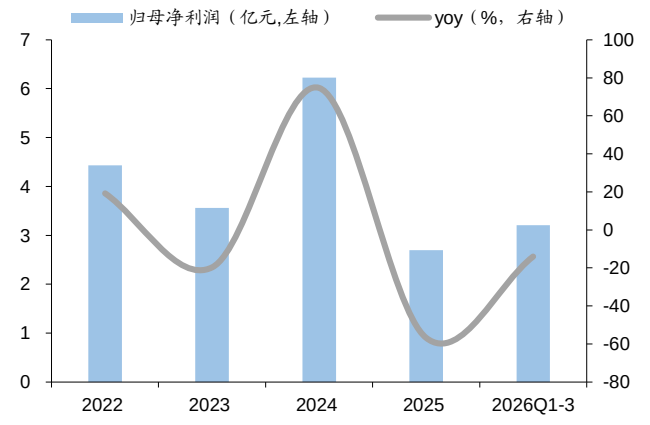
电连技术：2026 年前三季度实现营收 40.00 亿元，同比-0.97%；归母净利润 3.21 亿元，同比-13.98%；扣非归母净利润 3.19 亿元，同比-13.49%。2026Q3 单季度营收 13.79 亿元，同比-8.96%；归母净利润 1.15 亿元，同比-11.85%；扣非归母净利润 1.15 亿元，同比-11.33%。公司作为国内微型射频连接器龙头，受存储涨价及智能手机需求疲软影响，消费电子业务有所承压；汽车连接器已进入比亚迪、吉利、理想等主流车企供应链，2026H1 收入同比+8.67%，高速射频及车载以太网连接器持续拓展。与此同时，BTB 及数据中心高速线缆等新产品加快客户导入，H1 其他业务收入同比+29.25%，成为新的增长来源。前三季度财务费用同比增加约 0.35 亿元，主要受汇兑损失增加影响，叠加产品价格竞争及新增产能折旧，盈利能力有所承压。随着汽车智能化升级及高速互联产品逐步放量，公司业务结构有望持续优化，但短期利润修复仍取决于消费电子需求改善及新业务规模效应释放。

图表94：电连技术营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

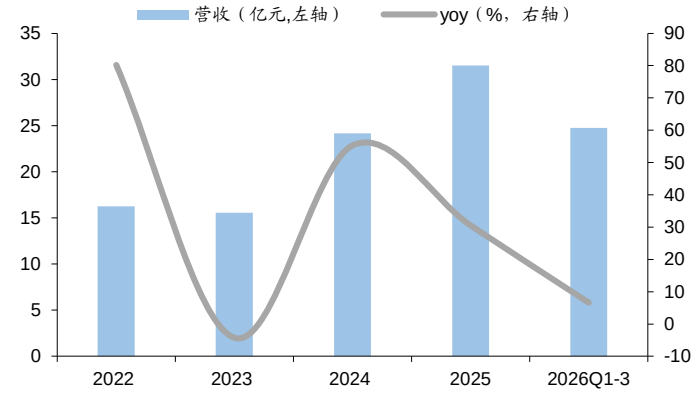
图表95：电连技术归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

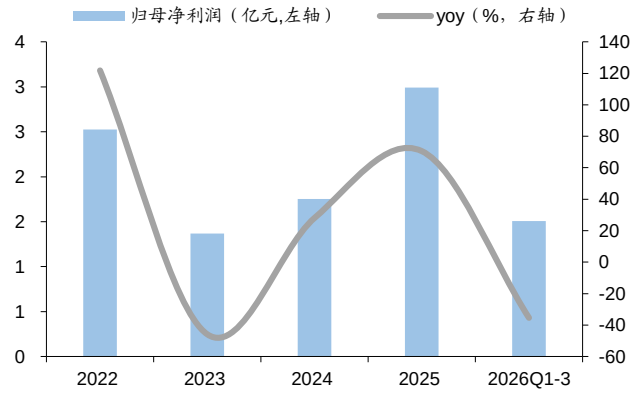
瑞可达：2026 年前三季度实现营收 24.74 亿元，同比+6.58%；归母净利润 1.51 亿元，同比-35.39%；扣非归母净利润 1.44 亿元，同比-34.41%。2026Q3 单季度营收 9.26 亿元，同比+16.28%；归母净利润 0.40 亿元，同比-47.83%；扣非归母净利润 0.37 亿元，同比-47.36%。公司作为国内新能源汽车及储能连接器领先厂商，受乘用车去库存及行业价格竞争影响，传统业务增长放缓；同时加快拓展 AI 数据中心高速互联业务，子公司瑞创已进入头部云服务商供应链，400G/800G AEC 产品逐步实现批量交付，1.6T 产品已向北美客户送样。前三季度收入增速低于期间费用增速，其中 Q3 研发投入同比+40.50%，叠加可转债利息及汇兑损失增加，盈利能力持续承压。随着高速铜缆订单交付及 1.6T 产品客户验证推进，公司数据中心业务有望贡献新增量，但短期利润修复仍需依赖新能源汽车业务企稳及费用摊薄。

图表96：瑞可达营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表97：瑞可达归母净利润情况

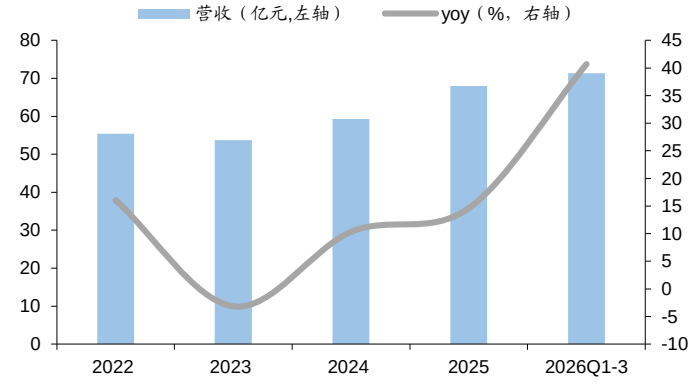


来源：ifind，国金证券研究所

3.5：半导体设计

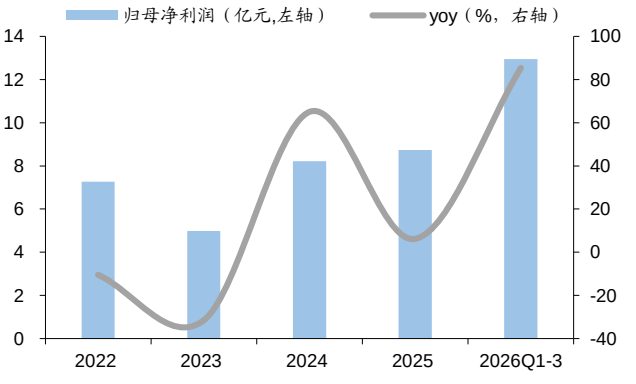
晶晨股份：2026 年前三季度实现营收 71.35 亿元，同比+40.70%；归母净利润 12.94 亿元，同比+85.38%；扣非归母净利润 12.34 亿元，同比+96.01%。2026Q3 单季度营收 27.44 亿元，同比+57.62%；归母净利润 6.83 亿元，同比+239.35%；扣非归母净利润 6.74 亿元，同比+290.57%。公司作为全球智能终端 SoC 龙头，受益高端电视芯片持续放量及海外客户拓展，智能电视 SoC 业务成为核心增长引擎。公司通过产品提价传导合封存储芯片成本上涨，叠加高端产品占比提升，前三季度毛利率同比+4.80pct 至 41.92%，推动 Q3 利润创历史新高。客户拓展方面，公司已进入三星电视供应链，计划 Q4 实现批量供货，索尼电视项目预计 2027Q1 完成量产定型；同时逐步持续向商显、机器人等新场景拓展。随着三星、索尼等国际客户逐步导入及高端电视 SoC 渗透率提升，公司产品结构及盈利能力有望持续改善，推动业绩延续较快增长。

图表98：晶晨股份营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

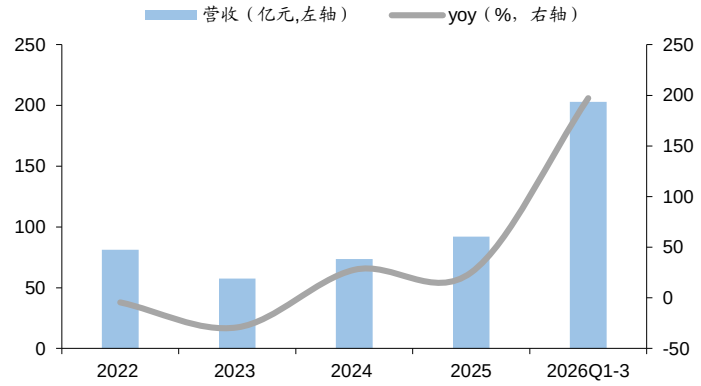
图表99：晶晨股份归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

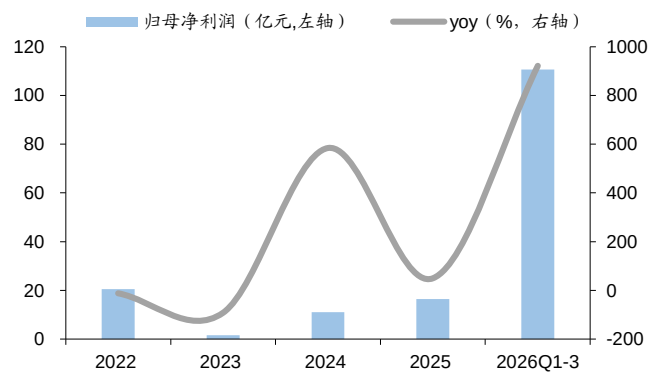
兆易创新：2026 年前三季度实现营收 202.97 亿元，同比+197.11%；归母净利润 110.66 亿元，同比+921.55%；扣非归母净利润 94.34 亿元，同比+805.26%。2026Q3 单季度营收 87.32 亿元，同比+225.65%；归母净利润 42.09 亿元，同比+728.93%；扣非归母净利润 45.51 亿元，同比+814.39%。公司作为国内存储芯片及 MCU 龙头，受益海外大厂退出利基 DRAM 及缩减 2D NAND 产能，存储产品供需持续偏紧，推动利基 DRAM、SLC NAND 量价齐升，2026H1 存储业务收入同比+245.44%；NOR Flash 价格温和上涨，工业、汽车领域需求增长，MCU 业务出货持续扩张。Q3 扣非利润环比+31.04%，主营盈利能力进一步增强；前三季度公允价值变动收益 18.78 亿元增厚累计利润，但 Q3 非经常性损益为-3.42 亿元，导致单季归母低于扣非。随着利基存储供需格局持续改善及产品结构升级，公司存储业务有望维持较高盈利水平，MCU 及定制化存储产品拓展进一步丰富增长来源。

图表100：兆易创新营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

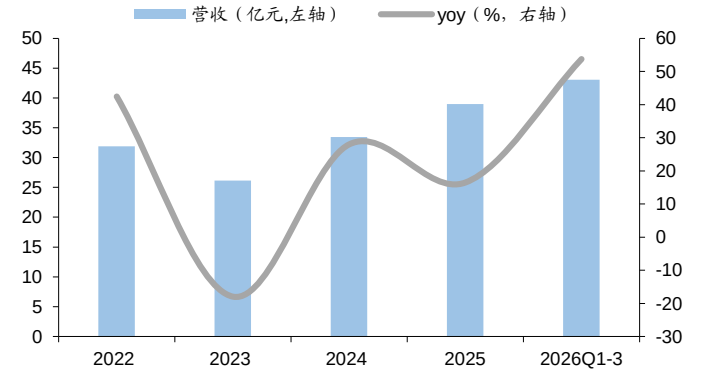
图表101：兆易创新归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

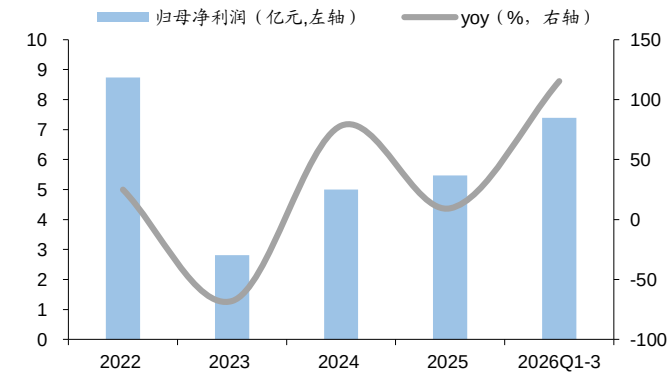
圣邦股份：2026 年前三季度实现营收 43.04 亿元，同比+53.69%；归母净利润 7.39 亿元，同比+115.28%；扣非归母净利润 6.53 亿元，同比+182.58%。2026Q3 单季度营收 17.09 亿元，同比+74.05%；归母净利润 3.19 亿元，同比+123.75%；扣非归母净利润 2.97 亿元，同比+207.65%。公司作为国内模拟芯片龙头，持续完善信号链及电源管理产品矩阵，2026H1 两大业务收入分别同比+49.71%/+35.45%，受益工业、汽车及高端消费等下游需求增长，产品销售规模持续扩大。截至 2026H1 公司已拥有 38 大类、7200 余款可供销售产品，平台化优势逐步增强。前三季度收入增长快于成本增长，叠加规模效应推动盈利能力改善，经营现金流净额同比+158.98%至 7.92 亿元。10 月公司拟以 8.33 亿元收购申矽凌 58.29%股权，补充温湿度传感器、数字接口及数模转换产品。随着高端产品放量及客户配套能力提升，公司主营业务有望延续较快增长，收购完成后产品及客户协同有望进一步拓展成长空间。

图表102：圣邦股份营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

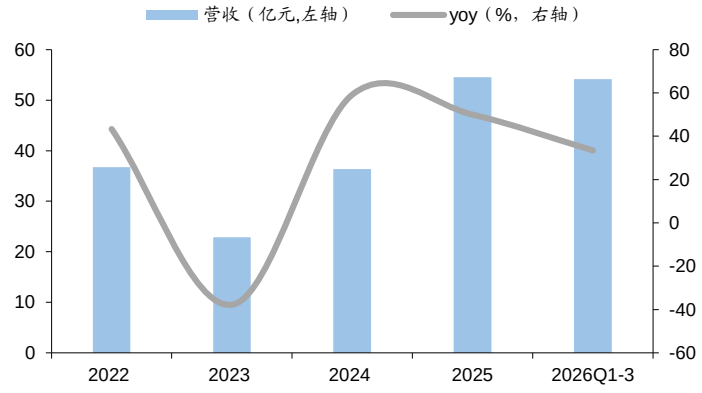
图表103：圣邦股份归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

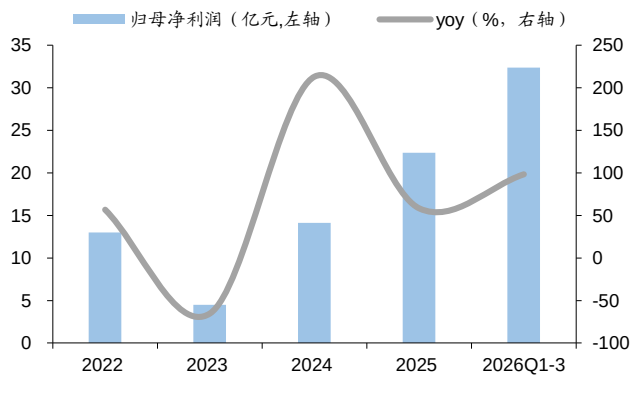
澜起科技：2026 年前三季度实现营收 54.14 亿元，同比+33.44%；归母净利润 32.37 亿元，同比+98.32%；扣非归母净利润 23.27 亿元，同比+58.60%。2026Q3 单季度营收 20.79 亿元，同比+45.97%；归母净利润 12.40 亿元，同比+161.98%；扣非归母净利润 10.05 亿元，同比+167.21%。公司作为全球内存互连芯片龙头，持续受益 AI 服务器需求增长及 DDR5 平台升级，第三至第五子代 RCD 芯片出货占比提升，MRCD/MDB、PCIe Retimer 等互连新品加速放量，推动 Q3 互连类芯片收入同比+49.3%至 20.47 亿元，毛利率同比提升 2.7pct 至 68.4%，盈利能力持续增强。前三季度投资收益及公允价值变动收益合计 9.04 亿元，对归母利润形成增厚。截至 10 月 26 日，公司预计 Q4 交付的互连类芯片在手订单达 25.0 亿-27.9 亿元。随着 DDR5 高世代产品渗透及互连新品持续放量，公司互连业务有望延续较快增长，充裕在手订单为 Q4 收入增长提供较强支撑。

图表104：澜起科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表105：澜起科技归母净利润情况

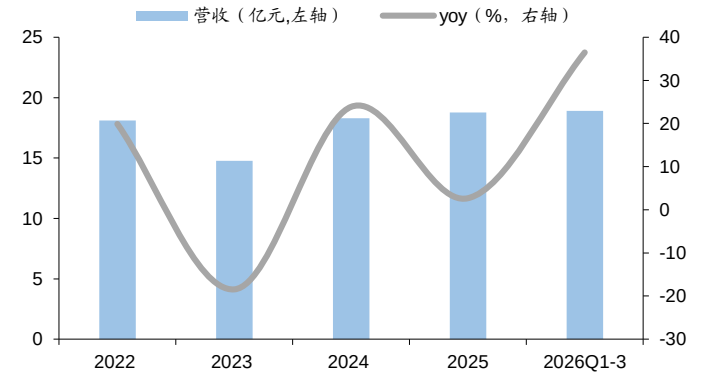


来源：ifind，国金证券研究所

3.6：功率半导体

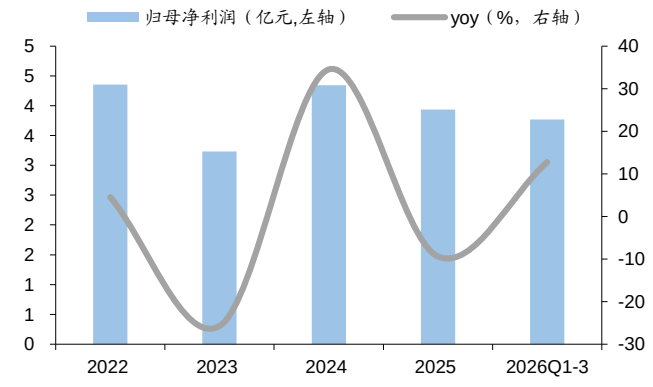
新洁能：2026 年前三季度实现营收 18.90 亿元，同比+36.44%；归母净利润 3.77 亿元，同比+12.73%；扣非归母净利润 3.49 亿元，同比+19.83%。2026Q3 单季度营收 7.23 亿元，同比+58.62%；归母净利润 1.44 亿元，同比+44.61%；扣非归母净利润 1.55 亿元，同比+84.87%。公司作为国内功率半导体领先厂商，产品覆盖 SGT-MOSFET、SJ-MOSFET、IGBT 及 SiC 等，持续受益 AI 数据中心、汽车电子及光伏储能等下游需求增长，中高端功率器件订单加快释放。前三季度公司持续推进产品、市场及客户结构优化，高端应用业务规模扩大，叠加产能提升推动 Q3 营收增速明显加快，扣非利润增速进一步提升；Q3 金融资产公允价值变动及处置损失约 0.23 亿元，对归母利润形成一定拖累。随着 AI 算力电源及新能源领域需求延续，公司中高端产品出货规模有望持续扩大，产品结构升级及产能利用率提升将进一步支撑主营盈利增长。

图表106：新洁能营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表107：新洁能归母净利润情况

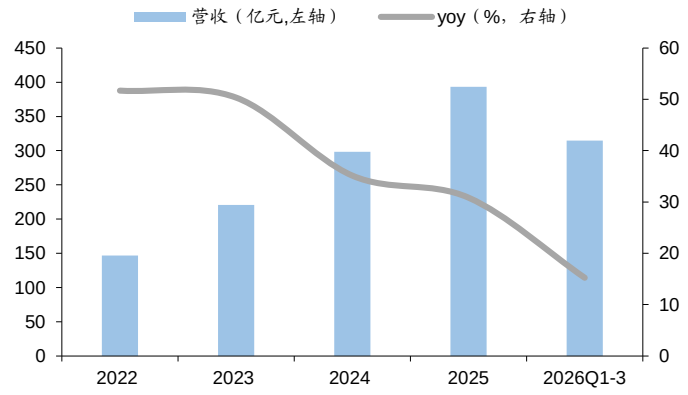


来源：ifind，国金证券研究所

3.7：半导体设备

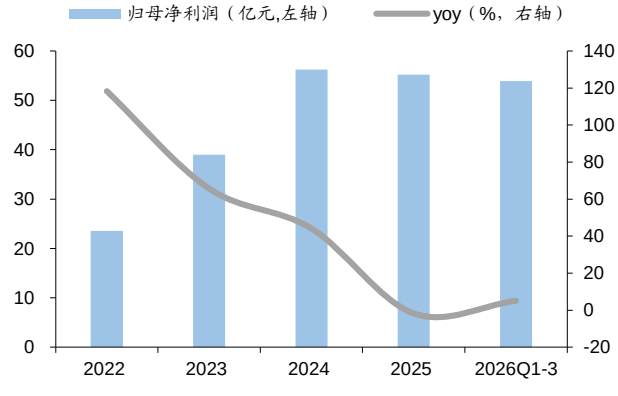
北方华创：2026 年前三季度实现营收 314.67 亿元，同比+15.26%；归母净利润 53.92 亿元，同比+5.10%；扣非归母净利润 53.21 亿元，同比+4.28%。2026Q3 单季度营收 113.06 亿元，同比+1.31%；归母净利润 20.22 亿元，同比+5.18%；扣非归母净利润 19.80 亿元，同比+3.06%。公司作为国内平台型半导体设备龙头，持续受益晶圆厂扩产及设备国产化，刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等设备市占率稳步提升，订单规模持续扩大，但部分物料供应紧张制约设备交付，导致 Q3 营收增速放缓。前三季度研发投入 54.27 亿元，同比+17.42%；销售费用同比+41.38%，叠加新品验证成本及大客户商务优惠，综合毛利率同比下降 1.97pct 至 39.44%，利润增长低于收入。前三季度经营现金流净额 55.91 亿元，同比+317.84%。随着供应链协同改善及在手订单逐步交付，公司收入增长有望恢复，新品批量导入将进一步巩固设备平台化竞争优势。

图表108：北方华创营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

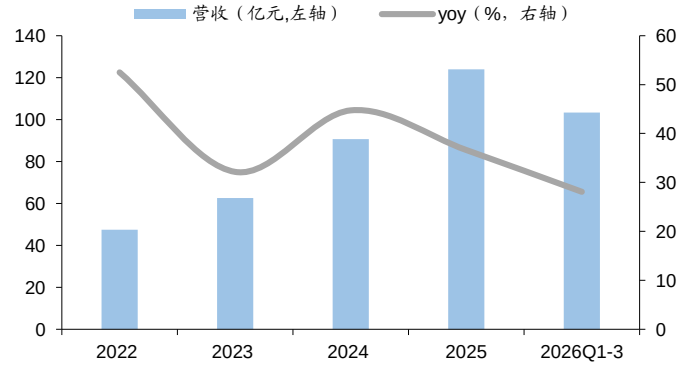
图表109：北方华创归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

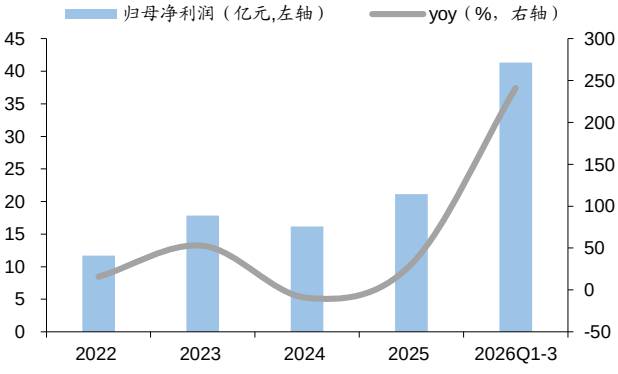
中微公司：2026 年前三季度实现营收 103.26 亿元，同比+28.08%；归母净利润 41.34 亿元，同比+241.31%；扣非归母净利润 16.23 亿元，同比+83.01%。2026Q3 单季度营收 36.35 亿元，同比+17.18%；归母净利润 13.09 亿元，同比+159.02%；扣非归母净利润 5.00 亿元，同比+43.77%。公司作为国内刻蚀设备龙头，持续受益先进逻辑、存储扩产及设备国产化，高端刻蚀设备新增付运量显著提升，多项关键刻蚀工艺已实现大规模量产，截至累计超 9300 个反应台进入国内外生产线。公司同步拓展薄膜沉积、化学机械抛光及量检测设备，前三季度研发支出 32.22 亿元，同比+27.70%，同时推进六大类、超 20 款新设备研发。前三季度毛利同比增加约 10.21 亿元，推动扣非利润较快增长；同期股权投资公允价值变动及投资收益合计 19.40 亿元，其中出售部分拓荆科技股份产生投资收益约 9.53 亿元，显著增厚归母利润。随着先进制程刻蚀设备持续放量及新品逐步导入，公司设备业务有望保持增长，多品类商业化进一步拓展中长期成长空间。

图表110：中微公司营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

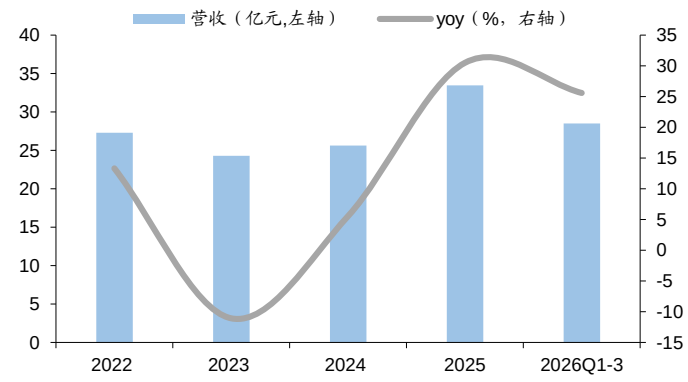
图表111：中微公司归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

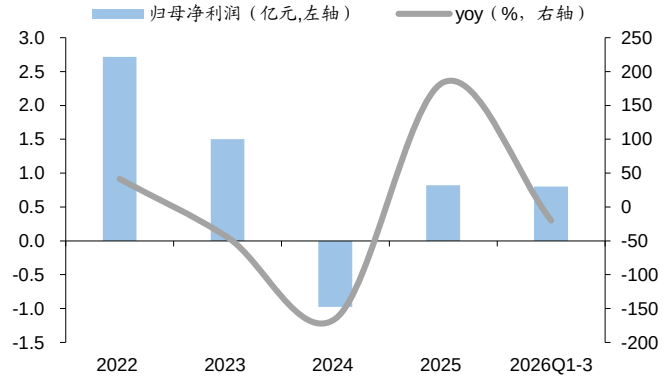
精测电子：2026 年前三季度实现营收 28.52 亿元，同比+25.61%；归母净利润 0.80 亿元，同比-20.04%；扣非归母净利润 0.24 亿元，同比-52.31%。2026Q3 单季度营收 10.40 亿元，同比+16.93%；归母净利润 0.05 亿元，同比-93.10%；扣非归母净利润-0.06 亿元，同比-108.32%。公司作为国内半导体量检测设备领先厂商，受益国内晶圆厂扩产及设备国产化，前道量检测订单持续增长，截至三季报披露日半导体在手订单 36.57 亿元，同比+105.34%；明场光学缺陷检测设备已实现 14nm 产线重复交付，多款产品进入先进封装产线。受生产场地及产能约束，部分订单交付周期延长，收入确认滞后；叠加股权激励费用影响，Q3 归母利润明显下滑，剔除股份支付费用后单季归母净利润约 1.16 亿元，同比+59.78%。随着 Q4 新建厂房逐步投产，产能瓶颈有望缓解，订单交付提速及规模效应将推动半导体业务收入与盈利逐步改善。

图表112：精测电子营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

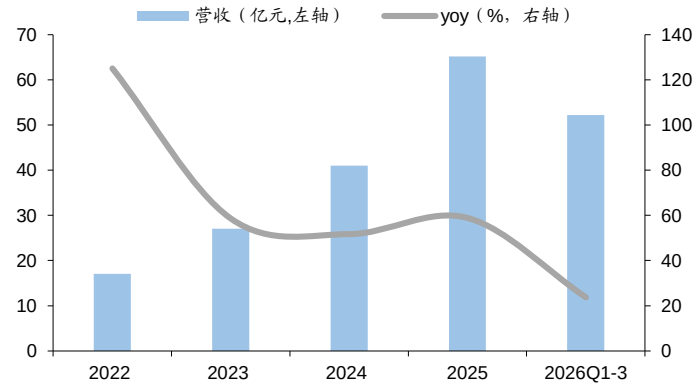
图表113：精测电子归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

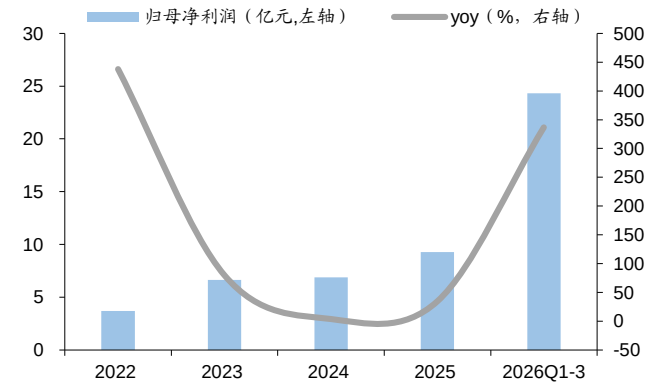
拓荆科技：2026 年前三季度实现营收 52.20 亿元，同比+23.70%；归母净利润 24.31 亿元，同比+336.79%；扣非归母净利润 9.29 亿元，同比+102.66%。2026Q3 单季度营收 23.08 亿元，同比+1.84%；归母净利润 10.88 亿元，同比+135.39%；扣非归母净利润 5.61 亿元，同比+33.63%。公司作为国内薄膜沉积设备龙头，持续受益先进存储、逻辑制程及设备国产化，PECVD、ALD 及沟槽填充等先进工艺设备客户端量产规模扩大，累计出货超过 4400 个设备反应腔；新一代晶圆对晶圆混合键合设备 Dione 300 eX 已通过客户验证。Q3 收入增长放缓主要受阶段性验收产品结构及平台类型变化影响，先进产品量产及规模效应推动前三季度毛利率同比+8.37pct；同期交易性金融资产公允价值变动收益同比增加约 16.16 亿元，显著增厚归母利润。随着先进工艺设备量产规模持续扩大，公司薄膜沉积业务有望保持增长，混合键合新品客户导入进一步拓展先进封装设备市场空间。

图表114：拓荆科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

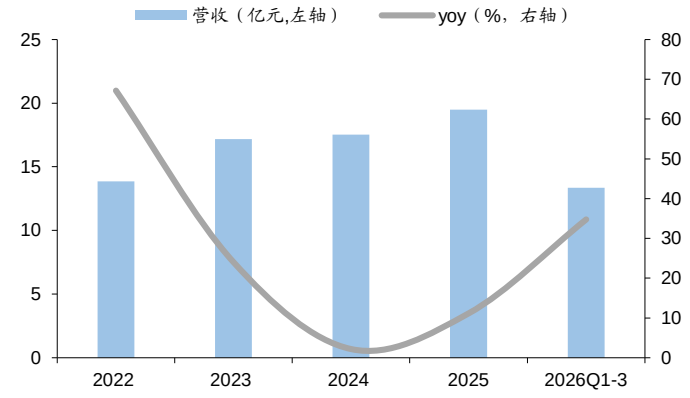
图表115：拓荆科技归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

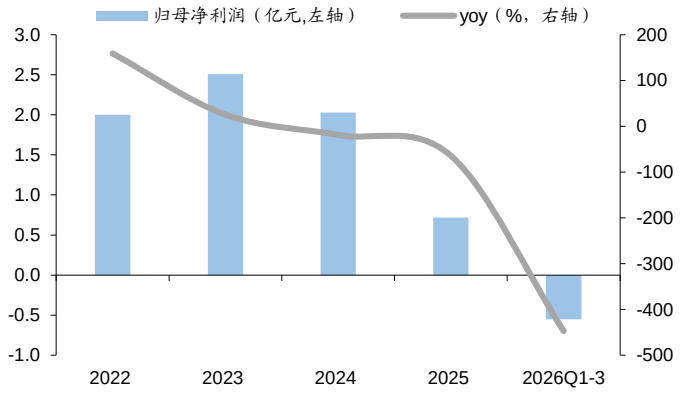
芯源微：2026 年前三季度实现营收 13.34 亿元，同比+34.73%；归母净利润-0.55 亿元，同比-447.27%；扣非归母净利润-1.21 亿元，同比-28.67%。2026Q3 单季度营收 4.37 亿元，同比+55.56%；归母净利润-0.63 亿元，同比-142.78%；扣非归母净利润-0.75 亿元，同比-70.79%。公司作为国内涂胶显影及湿法设备领先厂商，受益晶圆厂扩产及设备国产化，新签订单持续增长，前三季度前道、后道订单占比约为 4:6，前道清洗设备客户份额持续提升，涂胶显影新机型验证及导入顺利，预计 2027 年逐步放量。盈利端受部分战略客户订单让利、新产品导入及人员扩张影响，毛利率阶段性承压；Q3 研发投入同比+86.72%至 1.04 亿元，叠加政府补助减少，导致单季亏损扩大。公司通过战略备货及国产零部件导入缓解交付压力，Q4 仍是全年收入确认的主要阶段。随着前道新机型验证转化及清洗设备规模提升，公司收入有望维持增长，产品成熟度提升与费用摊薄将成为后续盈利修复的主要驱动。

图表116：芯源微营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表117：芯源微归母净利润情况

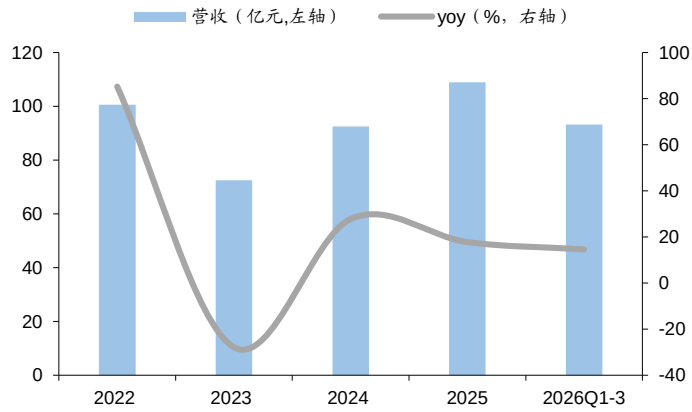


来源：ifind，国金证券研究所

3.8：晶圆代工

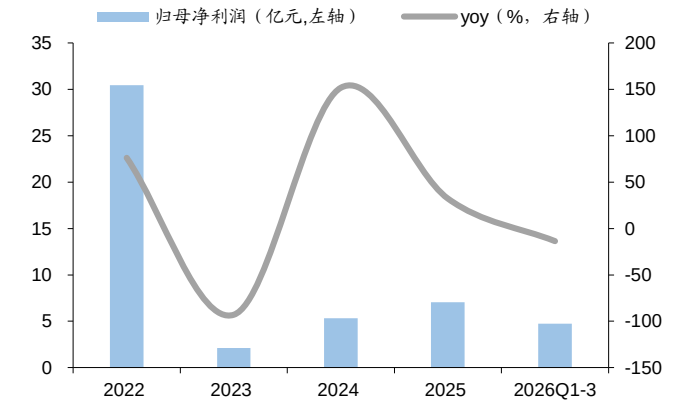
晶合集成：2026 年前三季度实现营收 93.10 亿元，同比+14.52%；归母净利润 4.75 亿元，同比-13.70%；扣非归母净利润 3.22 亿元，同比+41.32%。2026Q3 单季度营收 33.54 亿元，同比+14.42%；归母净利润 2.29 亿元，同比+5.23%；扣非归母净利润 1.91 亿元，同比+697.53%。公司作为国内 12 英寸晶圆代工领先厂商，以显示驱动芯片为基本盘，持续向 CIS、PMIC 及逻辑芯片等特色工艺拓展，产品销量增长带动收入规模扩大，2026H1 CIS 及 PMIC 业务收入占比分别提升至 25.34%和 12.82%。Q3 受被投资企业股价波动及汇率影响，分别产生公允价值变动损失 0.64 亿元、汇兑损失 0.79 亿元；剔除上述因素后，单季利润总额同比+135.58%，主营盈利改善趋势明确。公司持续推进 55nm 高阶 CIS 及 28nm 逻辑工艺平台客户导入，四期项目规划新增 5.5 万片/月 12 英寸产能。随着特色工艺产品持续放量及新增产能逐步释放，公司收入规模有望继续扩大，产品结构优化及规模效应将进一步推动盈利能力修复。

图表118：晶合集成营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表119：晶合集成归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

四、投资建议

一、AI 硬件算力产业链

AI 算力需求持续强劲，上半年产业链业绩高景气得到进一步验证。谷歌 TPU 等自研 ASIC 持续迭代，北美云厂商资本开支维持高位，先进制程及高端算力硬件需求旺盛。随着新一代 GPU 及谷歌、亚马逊等 ASIC 产品持续拉货，AI 服务器、高速交换机等需求有望继续保持较快增长，建议关注 AI 产业链硬件核心公司。目前多家 AI-PCB 公司订单强劲，高阶产能维持较高稼动率并持续扩产，高多层板、高阶 HDI 等高端产品需求旺盛；同时 AI 覆铜板需求持续提升，高端产能供给相对紧张，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。AI 覆铜板/PCB 的强劲需求也将进一步带动配套设备（钻孔机、直写光刻设备、钻针等）及上游电子布、铜箔等环节需求。

二、半导体芯片/存储/设备/零部件/材料产业链

半导体产业链逆全球化趋势延续，外部制裁及供应链安全需求推动国内设备、材料、零部件加快下游验证导入，自主可控及国产替代持续推进。2026 年上半年国内晶圆厂资本开支维持较高强度，先进逻辑及存储产线持续扩产，晶圆厂稼动率维持较高水平，设备板块收入保持较快增长；同时存储价格上行、国产 AI 算力芯片放量推动半导体设计板块

盈利能力显著改善。随着国内先进制程、先进存储产能持续建设以及核心设备、零部件和材料国产化率进一步提升，我们认为半导体产业链自主可控逻辑仍具有较强持续性，建议持续关注核心龙头公司。建议关注：北方华创、寒武纪、安集科技、中芯国际、汇成真空、鼎龙股份、江丰电子、思特威、芯源微、中微公司、长鑫存储、纳芯微。美股：博通、英伟达、台积电、天弘科技、Credo。

三、苹果创新、AI 智能眼镜、机器人受益产业链

存储价格上涨对苹果产业链影响无需过分悲观，2026-2027 年苹果硬件创新、端侧 AI 模型升级及新品周期仍值得期待。与此同时，苹果、微软、Meta、谷歌、OpenAI、亚马逊、三星、华为等大厂持续布局 AI/AR 眼镜，AI 机器人、AI 玩具及 AIoT 等新型终端加快发展。下半年伴随消费电子新品密集发布及端侧 AI 功能进一步落地，相关硬件创新有望持续推进；中长期建议关注 AR 智能眼镜光波导、SoC 芯片及核心零部件方向，随着技术成熟及产品体验改善，2027 年有望逐步进入放量阶段。建议关注：蓝特光学、立讯精密、东山精密、水晶光电、鹏鼎控股、瑞芯微、蓝思科技、歌尔股份、领益智造、恒玄科技。

五、风险提示

AI 技术迭代及商业化进展不及预期的风险：全球科技巨头持续加大 AI 基础设施及模型投入，若 AI 应用落地及商业化进展不及预期，或模型迭代带来的算力需求增长弱于预期，可能导致云厂商资本开支及 AI 硬件需求增速放缓，对相关产业链公司业绩产生影响。

外部制裁进一步升级的风险：全球贸易摩擦及科技领域出口管制持续，若美国、日本、荷兰等国家和地区进一步收紧半导体设备、零部件、材料及先进芯片相关出口限制，可能导致部分企业供应链、客户拓展及产品研发进度受到影响。

上游原材料价格上涨及成本传导不及预期的风险：PCB、消费电子等产业链涉及铜、铜箔、电子布、树脂等多类原材料，若原材料价格持续上涨，而相关企业向下游客户的价格传导不及预期，可能对产品毛利率及盈利能力产生不利影响。

终端需求不及预期的风险：若智能手机、PC 等消费电子终端创新及换机需求低于预期，AI 手机、AIPC、智能眼镜等新型终端渗透速度不及预期，或汽车、工业等下游需求恢复弱于预期，可能对相关产业链公司的收入增长及盈利能力产生影响。

行业投资评级的说明：

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；

增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；

中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；

减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。

特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海
电话：021-80234211
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn
邮编：201204
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 5 楼

北京
电话：010-85950438
邮箱：researchbj@gjzq.com.cn
邮编：100005
地址：北京市东城区建内大街 26 号新闻大厦 8 层南侧

深圳
电话：0755-86695353
邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：518000
地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806

【小程序】
国金证券研究服务

【公众号】
国金证券研究

行业投资评级的说明：

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；

增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；

中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；

减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。

特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海
电话：021-80234211
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn
邮编：201204
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 5 楼

北京
电话：010-85950438
邮箱：researchbj@gjzq.com.cn
邮编：100005
地址：北京市东城区建内大街 26 号新闻大厦 8 层南侧

深圳
电话：0755-86695353
邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：518000
地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806

【小程序】
国金证券研究服务

【公众号】
国金证券研究